



# 深圳市德明利技术股份有限公司

Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd.

(住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 A 座 2501、2401)

## 首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



(住所：东莞市莞城区可园南路一号)

## 发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自主做出投资决策，若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

# 目 录

发行人声明 .....	2
目 录 .....	3
<b>第一节重大事项提示 .....</b>	<b>5</b>
一、本次发行相关的重要承诺和说明.....	5
二、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响 .....	14
三、经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 .....	14
四、请投资者关注本次发行上市后公司的股利分配政策和未来三年的股利分配计划： .....	14
五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： .....	18
六、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况 .....	21
<b>第二节本次发行概况 .....</b>	<b>25</b>
<b>第三节发行人基本情况.....</b>	<b>28</b>
一、发行人基本资料.....	28
二、发行人历史沿革及改制重组情况.....	28
三、有关股本的情况.....	29
四、发行人业务情况.....	32
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 .....	44
六、同业竞争和关联交易情况.....	61
七、董事、监事、高级管理人员.....	69
八、发行人控股股东及实际控制人简介 .....	71
九、简要财务会计信息.....	72
十、管理层讨论与分析.....	80
<b>第四节募集资金运用 .....</b>	<b>87</b>
一、项目简表.....	87
二、募集资金投资项目前景分析 .....	87
<b>第五节风险因素和其他重要事项.....</b>	<b>92</b>

一、风险因素.....	92
二、重要合同.....	96
三、重大诉讼或仲裁事项.....	96
<b>第六节本次发行各方当事人和发行时间安排.....</b>	<b>97</b>
一、本次发行之各方当事人.....	97
二、与本次发行上市有关的重要日期.....	97
<b>第七节备查文件 .....</b>	<b>98</b>
一、备查文件内容.....	98
二、备查文件查阅时间、地点.....	98

## 第一节 重大事项提示

本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。

本公司提请投资者注意：

### 一、本次发行相关的重要承诺和说明

#### （一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人李虎、田华及实际控制人亲属孙铁军承诺：（1）其直接和间接所持公司股票自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不得提议由公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；（2）其在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。如在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守前述转让限制承诺及法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；（3）若公司存在重大违法情形并触及退市标准时，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，其不减持公司股票；（4）其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

实际控制人亲属李炎、罗会龙承诺：其直接和间接所持公司股票自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不得提议由公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价

低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

公司持有 5% 以上股份的其他股东魏宏章、金程源、徐岱群承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份；（2）若其拟减持公司股份，将在减持前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，持有公司股份低于 5% 以下时除外；（3）其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前不减持所持公司股份，持有公司股份低于 5% 以下时除外。

公司其他股东银程源、梅州菁丰、LeadingUI、谢红鹰、博汇投资、鸿福投资、湖南鼎鸿、锦宏一号、湖南欣宏源、湖南瑞希、深圳晋昌源、金启福、知仁投资、千杉幂方及正置公司均承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份；（2）其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份。

本次发行前间接持有发行人股份且同时担任公司董事、监事或高级管理人员的 CHEN LEE HUA、李国强、李鹏、何勇、叶柏林及何新宁均承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份；（2）其任在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。如其在任期届满前离职的，其承诺在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；另将遵循法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；（3）公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素

调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；（4）其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前不减持所持公司股份；（5）其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

## （二）关于公司股价稳定的承诺

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42号）的相关要求，制定了《深圳市德明利技术股份有限公司关于稳定公司股价的承诺函》，承诺函具体内容如下：

### 1、稳定公司股价预案启动情形

自公司股票上市之日起三年内，若某一年度出现公司股票连续 20 个交易日的每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同。若因除权除息等事项导致上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述收盘价应做相应调整），则启动稳定股价的措施。

### 2、责任主体

采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、控股股东（或实际控制人）以及公司的董事（不包括公司独立董事，下同）和高级管理人员。

应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后新聘任的董事、高级管理人员。

### 3、具体措施

股价稳定措施的顺序和具体方式包括：（1）公司回购股票；（2）控股股东（或实际控制人）增持公司股票；（3）董事（不包含独立董事）、高级管理人员增持公司股票等方式。

#### （1）回购措施

公司回购股份应满足相关法律、法规、规章、规范性文件规定的关于公司股

票回购的有关条件和要求，并在满足以下条件的情形下履行回购义务：

- 1) 回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
- 2) 回购价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格。
- 3) 单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。
- 4) 同一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%。
- 5) 公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的，在该三个月内不再履行回购义务。

## (2) 增持措施

采取增持股票措施应符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定，且增持股票的数量不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

### 1) 控股股东（或实际控制人）增持

公司控股股东（或实际控制人）在满足以下条件的情形下履行增持义务：

①公司已采取回购公众股措施，但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产。

②增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

③增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格。

④单次用于增持的资金金额累计不超过公司控股股东（或实际控制人）上一年度获得的公司现金分红金额（税后）的 20%。

⑤同一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司控股股东（或实际控制人）上一年度获得的公司现金分红金额（税后）的 50%。

⑥控股股东（或实际控制人）按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。

### 2) 非独立董事、高级管理人员增持

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在满足以下条件的情形下履行增持义务：

①公司已采取回购公众股措施且控股股东（或实际控制人）已采取增持股份措施，但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产。



②增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

③增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。

④单次用于增持的资金金额累计不超过公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和（税后）的 20%。

⑤同一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和（税后）的 30%。

⑥公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。

### （3）启动程序及实施期限

1) 控股股东（或实际控制人）、董事、高级管理人员增持的，应将增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）在触发启动稳定股价措施的情形之日起的 5 个交易日内提交公司并由公司进行公告。控股股东（或实际控制人）、董事、高级管理人员应在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。

2) 公司回购的，公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在触发启动稳定股价措施的情形之日起 5 个交易日内召开董事会讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

## 4、承诺

当触发前述稳定股价预案的启动条件时，公司控股股东（或实际控制人）、董事（不包含独立董事）、高级管理人员承诺严格按照公司股东大会审议通过的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关内容，履行增持公司股票的义务和责任。

### （三）关于发行人招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

#### 1、发行人承诺

发行人就公司首次公开发行股票并上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：

本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定后，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释【2003】2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

## 2、控股股东、实际控制人承诺

发行人控股股东李虎、实际控制人李虎和田华夫妇就公司首次公开发行股票并上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：

本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定后，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释【2003】2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

若本人未履行上述承诺，发行人有权相应暂扣应向本人支付的现金股利，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人履行相关的承诺义务为止。

## 3、董事、监事、高级管理人员承诺

发行人董事、监事、高级管理人员就公司首次公开发行股票并上市招股说明书真实、准确性事宜承诺如下：

本次发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定后，依法赔偿投资者损失。

若本人未履行上述承诺，发行人有权相应暂扣应向本人支付的薪酬，直至本

人履行相关的承诺义务为止。

#### **（四）有关证券服务机构关于其为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺**

##### **1、保荐人承诺**

东莞证券作为发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构及主承销商，承诺如下：

因东莞证券为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者的损失。东莞证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。

##### **2、发行人律师承诺**

信达律师作为发行人首次公开发行股票并上市的发行人律师，承诺如下：

信达律师为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

若因信达律师未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责，存在过错致使信达律师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，信达律师将依生效的司法判决或仲裁赔偿投资者损失。

##### **3、会计师承诺**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》有关规定，大信事务所作为发行人首次公开发行股票并上市的审计机构，承诺如下：

大信事务所对其出具的大信审字【2022】第 5-00041 号审计报告、大信专审字【2022】第 5-00028 号内控鉴证报告、大信专审字【2022】第 5-00029 号非经常性损益审核报告、大信专审字【2022】第 5-00031 号原始财务报表与申报财务报表差异审核报告、大信专审字【2022】第 5-00030 号主要税种纳税情况及税收优惠审核报告、大信验字【2020】第 5-00004 号验资报告、大信验字【2021】第 5-00018 号验资报告、大信验字【2020】第 5-00018 号验资报告专项复核报告的真实性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任，如果其

出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

#### **（五）持有公司5%以上股份的股东的持股意向及减持意向**

本次公开发行前持有公司 5% 以上股份的股东李虎、魏宏章、金程源、徐岱群就公司首次公开发行股票并上市后的持股意向及减持意向承诺如下：

1、拟长期持有公司股票；

2、减持前提：在承诺锁定期满后，在确有资金需求或其他投资安排时，将依据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，综合考虑资本市场、其他融资渠道等情况，审慎决定是否减持发行人股份；

3、减持方式：将依照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式进行；

4、减持价格：在承诺锁定期满后两年内，若其减持所持有的发行人股票，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项的，发行价应相应进行调整）；

5、减持发行人股份前，将提前 3 个交易日予以公告，但其所持发行人股份低于 5%时除外；

6、若违反上述承诺减持发行人股份的，违规减持所获资金将归发行人所有；发行人有权从应向其支付的现金股利中暂扣与违规减持所获资金相等的金额，直至其将违规减持所获资金上交发行人为止。

#### **（六）未履行承诺的约束措施**

##### **1、发行人关于未履行承诺的约束措施**

公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（1）如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员暂缓发放、调减薪酬或津贴;

3) 给投资者造成损失的, 公司将向投资者依法承担赔偿责任。

(2) 如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益。

### **2、控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施**

发行人控股股东李虎、实际控制人李虎和田华夫妇保证将严格履行公司股票发行上市过程中所作出的公开承诺的履行事项, 并承诺严格遵守下列约束措施:

“ (1) 本人应当及时、充分地在中国证监会指定的披露媒体上披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和社会公众投资者道歉;

(2) 本人应当向股东和社会公众投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的合法权益;

(3) 如因违反承诺给发行人或投资者造成损失(因不可抗力原因的除外), 本人将向发行人或投资者依法承担赔偿责任; 同时公司有权暂扣应向本人支付的现金股利, 直至本人履行相关的承诺义务为止。”

### **3、全体股东关于未履行承诺的约束措施**

本次发行前发行人全体股东保证将严格履行公司股票发行上市过程中所作出的公开承诺事项, 并承诺严格遵守下列约束措施:

“ (1) 本人/本公司/本企业应当及时、充分地在中国证监会指定的披露媒体上披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和社会公众投资者道歉;

(2) 本人/本公司/本企业应当向股东和社会公众投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律法规、规范性文件和公司章程的规定履行相关审批程序), 以尽可能保护投资者的合法权益;

(3) 如因违反承诺给发行人或投资者造成损失（因不可抗力原因的除外），本人/本公司/本企业将向发行人或投资者依法承担赔偿责任；同时公司有权暂扣应向本人/本公司/本企业支付的现金股利，直至本人履行相关的承诺义务为止。”

#### **4、发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施**

发行人董事、监事、高级管理人员保证将严格履行公司股票发行上市过程中所作出的公开承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

“（1）本人应当及时、充分地在中国证监会指定的披露媒体上披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）本人应当向股东和社会公众投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；

（3）如因违反承诺给发行人或投资者造成损失（因不可抗力原因的除外），本人将向发行人或投资者依法承担赔偿责任；同时公司有权暂扣应向本人支付的现金股利和薪酬，直至本人履行相关的承诺义务为止。”

## **二、公司股东公开发售股份对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响**

公司本次公开发行方案为拟公开发行新股不超过 2,000 万股，公司原股东不公开发售股份，故本次发行完成后不会因为控股股东公开发售股份导致公司实际控制人发生变更。

综上，本次发行对公司控制权、治理结构及生产经营等不会产生重大不利影响。

## **三、经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，公司本次公开发售前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。**

## **四、请投资者关注本次发行上市后公司的股利分配政策和未来三年的股利分配计划：**

### **（一）股利分配政策**

#### **1、公司的利润分配原则**

公司在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司的具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分听取独立董事和中小股东的意见。

## 2、利润分配形式和间隔期

公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

每一年度结束后，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

## 3、现金分红比例和条件

公司根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，原则上每一年度进行一次现金分红，且公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

(1) 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%。

(2) 若公司满足下述条件，则实施现金分红：

- 1) 公司该年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；
- 2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
- 3) 公司无重大资金支出安排；
- 4) 公司的资金状况能够满足公司正常生产经营的资金需求；
- 5) 公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1 元。

(3) 若公司未满足上述条件，或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利更有利于公司全体股东整体利益时，可采取发放股票股利方式进行利润分配。

#### 4、利润分配政策的决策机制和程序

(1) 公司董事会应根据公司的利润分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，并由独立董事对此发表独立意见后，方能提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(2) 公司应当严格执行公司章程规定的利润分配政策以及现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策和现金分红方案的，调整后的利润分配政策和现金分红方案不得违反证券监督管理部门和证券交易所的有关规定。

公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事、监事的意见，有关调整利润分配政策的议案需提交董事会、监事会审议，分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意，并由独立董事对此发表独立意见，方能提交公司股东大会审议并及时公告披露相关信息。公司股东大会审议调整利



利润分配政策相关事项的，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）未来三年具体股利分配计划

公司对上市后三年的利润分配安排如下：

1、公司在单一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数，且累计未分配利润为正数，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生（募集资金项目除外），公司连续三年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年度实现的年均可分配利润的 30%。

以上“重大投资计划”或“重大资金支出”是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分配的前提下，提出实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

2、公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程（草案）》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

3、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

5、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。

## **五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：**

### **（一）技术升级迭代风险**

集成电路设计行业技术升级和产品更新换代速度较快，并且发展方向具有一定不确定性，且存储主控芯片设计及固件方案主要以适配 NAND Flash 存储颗粒的产品架构、技术参数等为核心。因此，公司需要正确判断行业技术发展趋势并结合 NAND Flash 存储颗粒的技术发展方向和新工艺推出节奏对现有主控芯片设计及相应方案进行升级换代。未来若公司的技术升级迭代进度和成果未达预期，致使技术水平落后于行业升级换代水平或不能跟随 NAND Flash 的技术发展节奏，将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。

### **（二）研发失败的风险**

集成电路设计公司需要持续进行现有产品的升级更新和新产品的开发，以适应不断变化的市场需求。公司需要结合技术发展和市场需求，确定新产品的研发方向，并在研发过程中持续进行大量的资金和人员投入。由于技术的产业化和市场化始终具有一定的不确定性，未来如果公司在研发方向上未能正确作出判断，在研发过程中关键技术未能实现突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临研发失败的风险，前期的研发投入将难以收回，对公司业绩产生不利影响。

### **（三）核心技术泄密风险**

长期以来，公司持续的产品研发与技术创新为公司积累了丰富的技术成果。除部分知识产权已通过申请专利、软件著作权及集成电路布图设计专有权等方式进行保护外，另有多项自主研发的技术成果以技术秘密、非专利技术的形式保有。虽然公司采取了多种措施对核心技术和知识产权进行了保护，若未来出现未申请知识产权保护的核心技术大量泄密的情况，将可能使公司丧失技术竞争优势，对公司持续盈利能力造成不利影响。

### **（四）原材料价格波动风险**

公司产品主要为 NAND Flash 存储模组，产成品的成本构成中 NAND Flash 存储晶圆的占比较高，且市场上的 NAND Flash 存储晶圆主要由少数几家大型存储原厂生产、供应。随着 NAND Flash 工艺技术的不断进步及新技术、新工艺产

线的陆续投产，市场中总的存储当量供给快速增长，同时，随着社会科技进步，电子产品数字化、智能化的快速发展，社会各行业对存储当量的需求也不断上升。因此，受上下游技术进步及存储原厂产能扩张计划等导致市场总体供需情况变化，NAND Flash 存储晶圆及存储产品价格呈现周期性变动的特征。虽然 NAND Flash 存储晶圆的价格变动与下游存储产品的价格会相互影响并呈现一致趋势，但由于价格传导以及生产周期等因素影响，若未来 NAND Flash 存储晶圆价格大幅波动，将导致存储产品的利润率出现大幅波动，甚至可能需对公司存货等资产计提大额跌价准备，从而大幅减少公司盈利，在极端情况下将有可能导致公司营业利润出现周期性下滑，甚至出现亏损。

#### **（五）供应链整合风险**

公司专注于集成电路设计和技术研发，而将芯片制造、封装测试等生产或加工环节委托专业厂商进行。该模式符合集成电路产业垂直分工的特点，有利于提高公司的研发技术能力，降低产品生产成本，提高公司的资金使用效率。

在公司日常经营中，公司需要根据供应商的产能情况及公司的技术研发和市场销售节奏，对供应链进行有效整合，保证公司的产品生产效率和市场供应及时性，公司与多家芯片代工厂以及封装测试厂建立了长期稳定的合作关系，但在产品生产旺季，可能存在芯片代工厂或封装测试厂产能饱和，不能保证公司需求及时供应的风险，将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

#### **（六）存储卡和存储盘终端市场需求下降的风险**

公司产品主要包括存储卡模组、存储盘模组及固态硬盘模组等，其中，存储卡模组、存储盘模组等业务占比较高。从产品特性来看，存储卡应用范围广泛，在手机、GPS设备、数码相机、无人机、行车记录仪、掌上电脑、便携式播放器、智能音箱、电子游戏机等多种电子产品中可作为存储介质，为数据存储扩容和信息转移提供便利条件；存储盘即为日常所说的U盘，应用场景广泛，为人们日常生活中最常用的移动存储介质之一。虽然存储卡和存储盘产品在目前情况下已培育了客户使用习惯并形成了一定的刚性应用需求，但随着嵌入式存储产品及云存储技术的发展，存储卡和存储盘等移动存储产品存在需求萎缩的风险，如公司不能及时跟随市场情况进行技术研发更新、进行产品品类扩展，将对公司的产品销售和经营利润造成不利影响。

### **（七）关于无法充分获取NAND Flash存储晶圆的风险**

NAND Flash 存储晶圆是发行人产品的主要原材料，由于全球 NAND Flash 存储晶圆供货商只有三星电子（SAMSUNG）、海力士（SK Hynix）、美光（Micron）和英特尔（Intel）、西部数据/闪迪（SanDisk）和铠侠（KIOXIA）等少数大型企业，NAND Flash 市场呈现寡头垄断特征，货源供应受上述存储原厂的产能情况和其执行的市场销售政策影响较大。受益于国家对存储器芯片的重视度越来越高，在国家产业资金和政策层面的高度支持下，国内逐步成长出如长江存储（YMTC）、合肥长鑫等国产存储器芯片生产厂商，其中，长江存储（YMTC）经过多年的研发和设备投入，已开始逐步量产并向市场供应 NAND Flash 芯片产品，从根本上打破了 NAND Flash 芯片长期由境外厂商垄断的市场格局。但如果在未来的业务发展过程中，由于地缘政治或其他原因，发行人不能获取持续、稳定的 NAND Flash 存储晶圆供应，将会对公司的生产经营造成不利影响。

### **（八）经营性现金流风险**

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-14,279.15 万元、-1,326.68 万元和 1,062.43 万元，公司经营活动净现金流与实现的净利润有所差异主要系存储行业系资金密集型行业，公司为保持技术先进性、增强市场竞争力，持续进行研发投入和规模扩张，经营活动现金投入较大，公司主要通过股权融资和债权融资作为营运资金和规模扩张的有效补充。如果发行人经营活动现金流无法改善，或者发行人外部融资渠道不畅，可能会对公司现金流状况造成重大不利影响，上述事项可能成为发行人业务规模持续增长的发展瓶颈。

### **（九）所得税税收优惠政策变动的风险**

公司于 2016 年 11 月、2019 年 12 月分别被认定为国家高新技术企业。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，报告期内公司享受按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。同时，根据《中华人民共和国企业所得税法》、财税【2018】99 号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》等规定，公司开展研发活动中实际发生的研发费用可享受加计扣除。

未来如果税收优惠政策发生变化或发行人无法满足继续享有税收优惠政策的条件，将会影响发行人的盈利能力。

### **（十）汇率波动风险**

报告期内，公司外销收入金额分别为 57,458.56 万元、46,404.61 万元和 54,824.59 万元，占当期营业收入总额的 88.99%、55.59%和 50.77%，公司外销收入占比较高。公司境外销售区域主要集中在香港地区，并主要使用美元外币结算，公司子公司香港源德相应持有美元等外币货币性资产及负债。因此，报告期内受美元等外币兑人民币汇率不断波动的影响，公司报告期各期汇兑损益（正数为损失）分别为-219.30 万元、957.03 万元和 127.78 万元，汇兑损益的绝对值分别占当期利润总额的 4.62%、10.37%和 1.16%。报告期内，公司主要通过平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响，但如在未来期间相关外币兑人民币的结算汇率发生较大幅度波动，则公司将面临经营业绩受汇率波动影响较大的风险。

#### **（十一）存货跌价风险**

报告期各期末，发行人存货账面价值分别为 28,744.29 万元、43,742.30 万元和 56,554.83 万元，占流动资产的比例分别为 57.55%、60.19%和 58.10%，存货规模符合公司经营战略要求，但未来如果市场需求发生较大不利变化，造成存货积压，公司将面临资金周转困难。或者如果产品市场价格持续下跌，公司将面临存货跌价损失风险，这将对公司财务状况及经营成果带来不利影响。

#### **（十二）净资产收益率下降的风险**

本次募集资金到位后，公司的净资产规模将在短时间内大幅增加，但是募集资金投资项目需要一定的筹建期，项目达产也需要一定的时间，预计本次发行后公司的净资产收益率与以前年度相比将会出现一定下滑。截至 2021 年 12 月 31 日，公司净资产为 55,372.30 万元，假设按本次发行拟募集资金净额 45,589.24 万元测算，发行后净资产将大幅增加，在募投项目效益还未显现的情况下，净资产收益率将相应较发行前下降。因此，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。

## **六、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况**

### **（一）2022 年 1-3 月经营情况**

公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。大信事务所审阅了公司 2022 年 1-3 月的财务报表，包括 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、现金流量表和财务报表附注，并出具了大信阅

字【2022】第 5-00001 号审阅报告。

根据大信事务所出具的审阅报告，公司 2022 年 1-3 月主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022-3-31	2021-12-31	变动比例
资产总额	115,589.96	114,594.60	0.87%
负债总额	58,096.52	59,222.30	-1.90%
归属于母公司所有者权益合计	57,493.45	55,372.30	3.83%
所有者权益合计	57,493.45	55,372.30	3.83%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例
营业收入	24,799.68	21,473.04	15.49%
营业利润	1,935.51	1,898.89	1.93%
利润总额	2,050.77	1,898.89	8.00%
净利润	1,897.01	1,703.15	11.38%
归属于母公司股东的净利润	1,897.01	1,703.15	11.38%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,737.68	1,700.37	2.19%

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动额
经营活动产生的现金流量净额	-7,177.82	-1,950.30	-5,227.52
投资活动产生的现金流量净额	-458.21	-1,438.51	980.30
筹资活动产生的现金流量净额	-204.36	1,018.77	-1,223.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27.38	8.37	-35.75
现金及现金等价物净增加额	-7,867.76	-2,361.66	-5,506.10

4、非经常性损益项目情况

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	200.97	3.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4.42	-

减：所得税影响额	37.22	0.50
归属于母公司股东的非经常性损益净额	159.33	2.78

财务报告审计截止日后，公司经营状况良好。受公司产品市场认可度提升及存储行业回暖影响，2022年1-3月，公司经审阅的营业收入为24,799.68万元，较上年同期增长15.49%，归属于母公司股东的净利润为1,897.01万元，较上年同期增长11.38%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,737.68万元，较上年同期增长2.19%。

受下游需求稳定及上游供应充分影响，存储行业持续向好，2022年第一季度深圳、东莞地区爆发了短期新冠疫情，对发行人业务经营造成了短期不利影响，在此情况下，发行人营业收入保持了15.49%的业务增长，业务增长势头良好。

2022年1-3月，发行人净利润较去年同期增加11.38%，增幅低于营业收入增长幅度主要系：一方面，发行人继续加强技术研发投入，研发费用同比增幅较多；另一方面，随着发行人业务规模扩张及未来业务增长预期持续向好，发行人继续加强经营团队建设、扩增银行借款规模及资产规模，管理费用、财务费用、资产减值损失等同比增幅高于营业收入增幅。

2022年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-7,177.82万元，经营活动现金流量净额为负主要系发行人基于市场情况和业务需求积极开展原材料采购和产品的生产、销售，2022年一季度发行人购买商品、接受劳务支付的现金相对较多所致。

财务报告审计截止日后，公司产业政策、税收政策、行业周期及市场环境、业务模式、竞争趋势、主要原材料的采购规模，主要产品的生产、销售规模及销售价格、重大诉讼或仲裁、主要客户群体和供应商、重大合同条款及执行情况、安全生产情况未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，公司未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

综上所述，公司财务报告审计截止日后总体运营情况良好，不存在重大异常变动情况，公司持续经营能力未发生重大不利变化。

## （二）2022年1-6月经营业绩预计情况

根据管理层初步测算，公司预计2022年1-6月实现营业收入53,000万元至58,000万元，同比变动幅度约为10%至20%；预计2022年1-6月实现归属于母

公司所有者的净利润 4,400 万元至 4,800 万元，同比变动幅度约为 5%至 15%；  
预计 2022 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,900  
万元至 4,300 万元，同比变动幅度约为 0%至 10%。以上 2022 年 1-6 月业绩预计  
仅为管理层对经营业绩的合理估计，未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或  
承诺。



## 第二节本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	不超过2,000万股（含2,000万股），本次发行不安排公司股东公开发售股份		
发行后总股本	不超过8,000万股（含8,000万股）		
占发行后总股本的比例	不低于25%		
每股发行价格	26.54元/股		
发行市盈率	22.99倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	9.23元/股	发行前每股收益	1.5389元/股
发行后每股净资产	12.62元/股	发行后每股收益	1.1542元/股
发行市净率	2.10倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按截至报告期末未经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）		
发行方式	本次发行采用网上直接向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进行		
发行对象	在深圳证券交易所开设A股股票账户的境内自然人、法人投资者及其他机构（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象		
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>公司控股股东、实际控制人李虎、田华及实际控制人亲属孙铁军承诺：（1）其直接和间接所持公司股票自公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不得提议由公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；（2）其在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。如在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守前述转让限制承诺及法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；（3）若公司存在重大违法情形并触及退市标准时，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终</p>		

止上市前，其不减持公司股票；（4）其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

实际控制人亲属李炎、罗会龙承诺：其直接和间接所持公司股票自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不得提议由公司回购该部分股份；若因公司进行权益分派等导致持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

公司持有 5%以上股份的其他股东魏宏章、金程源、徐岱群承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份；（2）若其拟减持公司股份，将在减持前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，持有公司股份低于 5% 以下时除外；（3）其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前不减持所持公司股份，持有公司股份低于 5% 以下时除外。

公司其他股东银程源、梅州菁丰、LeadingUI、谢红鹰、博汇投资、鸿福投资、湖南鼎鸿、锦宏一号、湖南欣宏源、湖南瑞希、深圳晋昌源、金启福、知仁投资、千杉幕方及正置公司均承诺：

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份；（2）其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份。

本次发行前间接持有发行人股份且同时担任公司董事、监事或高级管理人员的 CHEN LEE HUA、李国强、李鹏、何勇、叶柏林及何新宁均承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份；（2）其在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。如其在任期届满前离职的，其承诺在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；另将遵循法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；（3）公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调

	<p>整后的本次发行的发行价，其直接或间接持有公司股票锁定期限将自动延长六个月；（4）其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前不减持所持公司股份；（5）其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>
承销方式	主承销商余额包销
预计募集资金总额	53,080.00 万元
预计募集资金净额	45,589.24 万元
拟公开发售股份股东名称	不适用
发行费用的分摊原则	不适用
发行费用概算	<p>共计7,490.76万元，其中：  保荐与承销费用4,481.00万元  审计及验资费用1,875.47万元  律师费用556.60万元  用于本次发行的信息披露费用536.79万元  发行手续费及材料制作费 40.90 万元</p> <p>（以上发行费用概算不含增值税，此费用数值保留 2 位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，为四舍五入原因造成。）</p>

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本资料

公司名称	深圳市德明利技术股份有限公司
英文名称	Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd.
注册资本	6,000.00 万元
法定代表人	田华
设立日期	2020 年 3 月 9 日（有限公司成立于 2008 年 11 月 20 日）
住所和邮政编码	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 A 座 2501、2401（邮编：518000）
电话号码	0755-23579117
传真号码	0755-23572708
电子信箱	dml.bod@twsc.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责人和电话号码	田华，0755-23579117

### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

发行人前身德名利有限成立于2008年11月20日，德名利有限设立时的注册资本为10万元，其中李虎认缴6万元、马珂认缴4万元，于公司注册登记之日起两年内分期缴足。德名利有限分别于2014年11月、2016年6月、2018年2月、2018年8月、2019年7月、2019年11月进行六次增资，均为货币出资，注册资本增至2,239.4168万元；分别于2011年1月、2012年11月、2014年11月、2014年12月、2017年12月、2018年12月和2019年11月进行七次股权转让。

2020年2月15日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议并通过关于整体变更设立股份公司等议案，以德名利有限截至2019年11月30日经审计的母公司报表净资产人民币316,077,697.45元按5.2680:1的比例折股，折合为股份公司总股本60,000,000.00元，超出部分256,077,697.45元计入股份有限公司资本公积。2020年3月9日，公司取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914403006820084202的《营业执照》，注册资本为6,000万元，企业类型为股

份有限公司。

本次整体变更为股份公司后至本招股说明书摘要签署之日，公司的股权结构未发生变化。

### 三、有关股本的情况

#### （一）总股本、本次发行的股本、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为 6,000 万股，本次拟发行 2,000 万股，占发行后总股份的 25.00%，发行后总股本为 8,000 万股，上述股份均为流通股。公司关于本次发行的股份流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”。本次发行前后，公司的股本结构如下表所示：

单位：万股

股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
	股数	比例	股数	比例
李虎	3,208.89	53.48%	3,208.89	40.11%
魏宏章	803.78	13.40%	803.78	10.05%
金程源	445.44	7.42%	445.44	5.57%
徐岱群	428.68	7.14%	428.68	5.36%
银程源	177.02	2.95%	177.02	2.21%
梅州菁丰	165.74	2.76%	165.74	2.07%
LeadingUI	160.76	2.68%	160.76	2.01%
谢红鹰	133.96	2.23%	133.96	1.67%
博汇投资	110.49	1.84%	110.49	1.38%
鸿福投资	86.26	1.44%	86.26	1.08%
湖南鼎鸿	60.77	1.01%	60.77	0.76%
锦宏一号	44.19	0.74%	44.19	0.55%
湖南欣宏源	41.43	0.69%	41.43	0.52%
湖南瑞希	41.43	0.69%	41.43	0.52%
深圳晋昌源	30.38	0.51%	30.38	0.38%
金启福	19.33	0.32%	19.33	0.24%
知仁投资	13.81	0.23%	13.81	0.17%
千杉慕方	13.81	0.23%	13.81	0.17%
正置公司	13.81	0.23%	13.81	0.17%

本次拟公开发行股份	-	-	2,000.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 发行人股东情况

### 1、发起人

公司整体变更为股份公司时，各发起人的持股情况如下表：

序号	发起人姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李虎	32,088,887	53.4816
2	魏宏章	8,037,807	13.3963
3	金程源	4,454,419	7.4240
4	徐岱群	4,286,830	7.1447
5	银程源	1,770,241	2.9504
6	梅州菁丰	1,657,396	2.7623
7	LeadingUI	1,607,561	2.6793
8	谢红鹰	1,339,634	2.2327
9	博汇投资	1,104,853	1.8414
10	鸿福投资	862,615	1.4377
11	湖南鼎鸿	607,672	1.0128
12	锦宏一号	441,943	0.7366
13	湖南欣宏源	414,322	0.6905
14	湖南瑞希	414,319	0.6905
15	深圳晋昌源	303,834	0.5064
16	金启福	193,349	0.3222
17	知仁投资	138,106	0.2302
18	千杉幂方	138,106	0.2302
19	正置公司	138,106	0.2302
<b>合计</b>		<b>60,000,000</b>	<b>100.0000</b>

### 2、前十名股东

本次发行前，公司共 15 名非自然人股东及 4 名自然人股东，其中前十名股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李虎	32,088,887	53.4816
2	魏宏章	8,037,807	13.3963
3	金程源	4,454,419	7.4240

4	徐岱群	4,286,830	7.1447
5	银程源	1,770,241	2.9504
6	梅州菁丰	1,657,396	2.7623
7	LeadingUI	1,607,561	2.6793
8	谢红鹰	1,339,634	2.2327
9	博汇投资	1,104,853	1.8414
10	鸿福投资	862,615	1.4377
合计		<b>57,210,243</b>	<b>95.3504</b>

### 3、前十名自然人股东

本次发行前，公司共 4 名自然人股东，公司自然人股东持股数量、持股比例以及在公司的任职情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)	在发行人任职情况
1	李虎	32,088,887	53.4816	董事长、常务副总经理
2	魏宏章	8,037,807	13.3963	无任职
3	徐岱群	4,286,830	7.1447	无任职
4	谢红鹰	1,339,634	2.2327	无任职

### 4、国家股或国有法人股

本次发行前，公司股东中不存在国家股或国有法人股股东。

### 5、外资股

公司已于 2020 年 1 月 16 日取得深圳市龙华区商务局《外商投资企业变更备案回执》（粤深华外资备 202000039）。本次发行前，公司存在的外资股东为 LeadingUI、正置公司，基本情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	LeadingUI	1,607,561	2.6793
2	正置公司	138,106	0.2302

### （三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)	关联关系
1	谢红鹰	2.2327	谢红鹰持有博汇投资 99.00% 的份额
2	博汇投资	1.8414	

除上述关联关系外，公司股东之间不存在亲属关系或受同一控制等关联关系。

## 四、发行人业务情况

### （一）发行人主营业务情况

公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。

公司以闪存主控芯片的自主设计、研发为基础，结合主控芯片固件方案及量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案，高效实现对 NAND Flash 存储颗粒进行数据管理和应用性能提升。报告期内，公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组，主要聚焦于移动存储市场，相关产品广泛应用于消费电子、工控设备、家用电器、汽车电子、智能家居、物联网等诸多领域。

此外，公司还在人机交互触控领域完成初步业务布局，目前，公司已完成自研触摸控制芯片投片，并在此基础上形成针对不同应用场景的触控模组一体化解决方案，并实现小批量试产出货，为客户提供 6.5 寸至 21.5 寸的小、中、大多尺寸显示屏的触控芯片产品，并逐步导入智能家电领域、后装车机领域和中大屏商显领域等市场。

### （二）发行人主要产品或服务及其用途

#### 1、存储业务产品

闪存（Flash）属于半导体介质存储器，应用原理为利用电能方式存储数据信息，数据的写入与读取过程体现为电子的存储或释放，目前被广泛应用于消费电子、智能终端、工控设备、安防设备、服务器以及军工等诸多领域，是当前最为主流的非易失性存储器，其区别于以磁盘（曾广泛应用于 PC 硬盘、移动硬盘等领域）为代表的利用磁能方式以及磁性盘片的机械运动存储信息的磁介质存储设备。基于闪存技术的存储器产品目前处于持续取代磁盘存储器产品的市场趋势。闪存存储器产品根据存储芯片类型主要分为 NAND Flash 和 NOR Flash，发行人产品主要为 NAND Flash 存储模组。



公司的存储业务均系基于闪存技术的研发与应用，以闪存主控芯片的设计、研发为基础，结合主控芯片固件方案及量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案，最终通过存储模组产品形式实现销售。公司研发的闪存主控芯片内置电压侦测电路、多路稳压器等电路结构，同时公司的存储管理方案通过集成自主设计的 OTP 芯片 BOOT 代码扩编技术、基于硬件的实时在线编码技术、检测和错误自动纠正算法、基于硬件 ALU 算法模块上开发的动态坏块管理技术、坏块区域链式管理和集中规划算法等，增强了对 NAND Flash 的存储管理能力，提高了存储模组稳定性，降低产品成本，并适配兼容各种主流消费电子设备。另外，公司还通过采用 Automatic Clock Gating(自动门控时钟)和 Multi Power Domain (多电源域) 等降低功耗技术，达到性能和功耗的最佳平衡，同时通过使用 Mapping Table (映射表格)、擦写均衡技术、碎片整理技术和数据缓冲管理等技术，在产品应用上保持了良好的弹性，使公司的存储管理方案能够快速稳定支持不同厂商不同制程的 NAND Flash。截至本招股说明书摘要签署之日，公司自研的闪存主控芯片情况如下：

序号	芯片型号	投产成功时间	芯片名称	芯片特点
1	TW8581	2022年1月	USB3.2 超高速 5GHZ 存储控制芯片	TW8581 是一款带有超高速接口的闪存控制器芯片，支持 USB3.2 GEN1 的双工传输接口，传输频率运行在 5GHZ 频段；主控芯片支持高性能，高纠错能力的 ECC 硬件引擎，高效 IOPS 算法加速模块。支持 三星电子，铠侠，海力士等主流的 3D 制程的闪存；内置 DC-DC 调压系统，进步一步降低整机功耗。
2	TW2983	2021年5月	SD5.1 存储卡控制芯片	TW2983 是一款可兼容 SD5.1 接口协议、55nm 工艺制程的存储卡控制芯片，其在已量产的 TW2981 基础上，大幅提升了 random read/write IOPS 的性能，优化了 power manage 模块，改善了对车载行车记录仪和监控等设备的兼容性，进一步优化闪存管理算法，支持最新的 128/144 层 3D TLC/QLC Flash，特别是支持国产长江存储 32/64/128 层 3D TLC/QLC 等闪存。
3	TW8381	2020年12月	USB 存储盘控制芯片	TW8381 是一款 40nm 制程的 USB2.0 存储盘控制芯片，支持最新的 128/144 层 3D TLC/QLC Flash，支持 3.3/1.8/1.2V VCCQ 和 3.3/2.5V VCC 高速闪存，具有较好的性能和成本优势，可用于制作 USB 加密盘、分区盘、启动盘等。
4	TW29	2020	SD3.0 /4.0/5.0	TW2981 是一款兼容 SD3.0/4.0/5.0 接口协议、55nm

	81	年 5 月	存储卡控制芯片	工艺制程的存储卡控制芯片，与闪存搭配可以制作 SD、Micro SD 等各类型存储卡。它能提供高性能的数据传输，内置 ECC 纠错算法，加速算法专用协处理器，闪存管理算法等，从而能够广泛的支持市面上的三星电子、铠侠、海力士、英特尔、闪迪等各家存储原厂 2x、1x nm 等制程的 SLC/MLC/TLC 2D 闪存以及 32/64/72/96 层等 3D MLC/TLC/QLC 闪存。该芯片内置 2.5V/1.8V/1.2V 电源管理。
5	TW2980	2018 年 3 月	SD3.0 存储卡控制芯片	TW2980 是一款兼容 SD3.0 接口协议、110nm 工艺制程的存储卡控制芯片，与闪存搭配可以制作 SD、Micro SD 等各类型存储卡。它能提供高性能的数据传输，内置 ECC 纠错算法，加速算法专用协处理器，闪存管理算法等，从而能够广泛的支持市面上的三星电子、铠侠、海力士、英特尔、闪迪等各家存储原厂 2x、1x nm 等制程的 SLC/MLC/TLC 2D 闪存以及 32/64/72/96 层等 3D MLC/TLC 闪存。 该芯片内置 OTP 存储器，可用于存放密钥等加密相关数据，制作可靠的加密存储卡，也可用于存放关键参数、程序代码等，从而提高存储卡的稳定性和使用寿命。该芯片内置 1.8V/1.2V 电源管理。
6	TW8380	2017 年 12 月	USB 存储盘控制芯片	TW8380 是一款兼容 USB2.0/1.1 接口协议、110nm 工艺制程的存储盘控制芯片，与闪存搭配可以制作 USB 加密盘、分区盘、启动盘等。该芯片内置 ECC 纠错算法，加速算法专用协处理器，闪存管理算法等，从而能够广泛的支持市面上的三星电子、铠侠、海力士、英特尔、闪迪等各家存储原厂 2x、1x nm 等制程的 SLC/MLC/TLC 2D 闪存以及 32/64/72/96 层等 3D MLC/TLC 闪存。 该芯片内置 3.3V/1.8V/1.2V 电源管理模块，内置晶振和时钟校准模块，减少 PCB 外围器件，降低整机成本且易于售后维护。另外，该芯片也支持 LQFP48、QSOP28、QSOP24 等引脚少、体积小、成本低的封装方式。
7	TW9080	2017 年 10 月	NOR 存储器控制芯片	TW9080 是一款支持 NORFlash 存储器的存储卡控制芯片，与 NOR 型闪存存储器搭配可以制作用于广告推广、登录认证、预录内容的存储卡。 该芯片内置特有的针对 NOR 闪存的 ECC 纠错算法和闪存管理算法，支持市面上主流的三星电子、台湾旺宏等厂家的 NOR 闪存，该芯片内置 1.8V/1.2V 电源管理。
8	TW2880	2016 年 3 月	SD2.0 存储卡控制芯片	TW2880 是一款兼容 SD4.0/3.0/2.0/1.1 接口协议、110nm 工艺制程的存储卡控制芯片，与闪存搭配可以制作 SD/Micro SD 等各类型存储卡。该芯片内置 ECC 纠错算法，闪存管理算法等，从而支持市面上

				的三星电子、铠侠、海力士、英特尔、闪迪等各家存储原厂 2x、1x nm 等制程的 SLC/MLC/TLC2D 闪存，该芯片内置 1.8V/1.2V 电源管理。
--	--	--	--	---

报告期内，公司的存储模组产品主要为不同容量等级的存储卡、存储盘、固态硬盘等模组产品，具体情况如下：

### （1）存储卡模组

存储卡是一种利用闪存技术存储数据信息的存储器，其尺寸小巧，外形多为卡片形式，具体产品形态包括 SD 卡、Micro SD 卡、NM 卡等，主要应用于手机、GPS 设备、数码相机、无人机、安防摄像头、掌上电脑、便携式播放器、智能音箱、电子游戏机等电子产品中作为存储介质，具体应用领域如下图：



### （2）存储盘模组

存储盘即为日常所说的 U 盘，是一种通过 USB 接口进行数据传输，利用 NAND Flash 存储芯片进行存储的可移动数据存储装置，目前已经成为人们日常生活中最常用的移动存储介质之一，具体如下图：



### (3) 固态硬盘模组

固态硬盘模组为使用固态电子存储芯片阵列制成，系为了满足大容量存储应用场景需求的存储介质，主要包括 SSD、PSSD 等产品形式，被广泛应用于 PC、数据中心、人工智能、工控、安防、网络终端、医疗、航天、军工等诸多领域，具体如下图：



## 2、触控业务产品

随着十余年来电子信息技术和智能手机等智能终端设备的发展及应用普及，显示屏触摸控制技术已成为各类型消费电子产品所采用的最为主流的人机交互方式，同时，随着近年来中、大尺寸触摸屏控制技术的不断发展、成熟，显示屏触控技术开始向家用电器、汽车电子、广告商显和工控设备等更为广泛的应用领域延伸，与传统物理按键操控方式相比，能够为消费者或使用者提供更为便捷的人机交互方式、更为丰富的集成功能选项、以及更为精美的工业设计形态等，具有较为广阔的增量市场空间。

公司研发的触控芯片内置高性能 MCU，具有自主研发的高压生成模块和差分感应技术，通过 Frame ALU 提供高性能算法。由此获得抗高阻抗、抗强干扰的能力，在各领域保障稳定的触摸性能。截至本招股说明书摘要签署之日，公司自研的触控芯片情况如下：

芯片型号	技术特征	应用领域
TW3118	添加了高压工程和整流技术用于支持双模差分感应技术和 Frame ALU，不仅适用于高阻抗应用，而且具有出色的抗干扰能力；对各种干扰源进行分类，研发了一一对应的算法，可在强干扰环境中应用。通过改善 IC 处理能力，使之符合大型屏的相对大的充电时间；强化环境处理技术，使之符合电源变化大、干扰强、温湿度急剧变化的户外应用。	应用于智能家电、汽车电子等大干扰触控领域以及广告机、收银机、点餐机和点唱机等大屏设备。

目前，公司触控芯片可适用于包括智能家电、后装车机、大型商业显示屏、POS 机、KTV 点唱机等多样化的应用场景领域。具体如下图：



### (三) 产品销售方式和渠道

公司未运营自己的终端品牌，公司出货的移动存储模组通常为尚未标识商标、尚未包装外壳的商品，客户主要对公司的存储模组进行贸易分销或对存储模组进行外壳包装、印刷商标等形成最终商品后进行销售。

从市场分布和产品特点来看，公司销售的存储卡、存储盘等移动存储模组为具有国际通用标准的产品，应用范围广，全球客户分布呈现广而散的特点，尤其是发展中国家或地区市场，如：非洲、南美、南亚和中东等地区有大量当地中小品牌甚至非品牌客户需求，且单一客户需求量相对有限，集成电路设计企业需要借助优质渠道商更专业有效地完成市场开拓、客户维护等产品销售方面工作。

此外，随着全球化产业链分工深化，消费电子产业聚集、转移效应日益显现，中国自 2000 年以来逐步成为存储器产品的全球主要集散地，尤其以深圳华强北等电子市场为交易平台，以香港自由港转口贸易市场为依托，辐射世界各地的存储器消费者，并逐渐形成了一批具有贴牌、丝印加工能力，以渠道分销赚取利润为目的的渠道商群体。

因此，根据行业特点，公司销售主要采用“渠道分销和品牌、厂家直销相结合”的销售模式，通过利用深圳及香港发达的电子产品市场区位优势及市场中的专业化渠道商在全球范围内进行存储模组产品分销，服务大量广而散的客户。通过该种销售模式可以使公司更好的专注于产品的设计、研发环节，提高产业链的分工合作效率。

#### 1、渠道分销模式

公司已建立了成熟完善的渠道客户管理制度。通过比较信誉、资金实力、市场影响力、客户服务水平、行业背景、终端资源等因素，公司择优选择渠道客户。同时，为加强对渠道客户的管理，公司会不定期的对渠道客户进行实地拜访和调查，了解渠道客户的库存情况及市场动向。

公司每年与主要渠道客户签订年度产品销售协议，渠道客户以具体订单的形式对公司产品进行采购，具体包括产品类型、数量、价格及交货日期等；公司定期与客户进行对账，经客户确认无异议后在账期内付款。

#### 2、品牌和厂家直销模式

依靠稳定可靠的产品质量，公司获得了较好的行业口碑及细分领域内较强的产品竞争力，公司存储模组产品已导入朗科科技（Netac）、爱国者（Aigo）、喜宾（Banq）、忆捷（Eaget）、镁鲨（MIXZA）、金速（Kingfast）等知名存储卡、存储盘或固态硬盘品牌商以及雷科防务（002413）、大华股份（002236）等知名上市公司的供应链体系。公司产品直接销售给终端品牌客户或下游贴牌加工厂商，有利于缩短销售环节，提高对客户需求的响应速度，随着报告期内公司经营规模不断扩大，市场竞争优势日益增强，公司品牌和厂商直销模式的销售收入比例呈增长趋势。

#### （四）主要原材料情况

公司主要从事存储卡和存储盘等产品的闪存主控芯片设计及固件方案开发等，并形成系统的存储管理应用方案。公司通过对外采购存储晶圆，将其与闪存主控芯片等进行封装后形成存储模组产品，其中，公司存储模组使用的闪存主控芯片包括 Fabless 自研生产和外部采购主控芯片（包括由封装厂商配供市场主流闪存主控芯片）两种方式。

报告期内，公司自研闪存主控芯片及其他自研芯片的生产制造均委托中芯国



际（SMIC）、台湾联电（UMC）等芯片代工厂完成，存储模组产品的封装、测试等加工工序则主要委托外部封装测试厂商完成。另外，为了进一步掌握不同批次晶圆 Wafer 的品质差异特征、加强公司的测试能力、保障产品品质，公司于 2019 年自行架设了测试中心（大浪分公司），主要进行部分存储晶圆及产成品测试、程序调试等，此外，2020 年以来，随着公司固态硬盘业务规模增长，公司在测试中心增设了 SSD 模组贴片生产线，具备一定自行组装、生产 SSD 模组的能力。

报告期内，公司主要项目采购金额及占采购总额的比例如下：

单位：万元

项目	2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
NAND Flash 晶圆	79,336.94	74.55%	63,590.66	76.37%	50,519.14	76.87%
芯片代工	1,922.33	1.81%	566.78	0.68%	651.98	0.99%
存储晶圆测试	559.89	0.53%	835.70	1.00%	819.48	1.25%
晶圆颗粒封装测试	2,860.74	2.69%	1,487.37	1.79%	225.90	0.34%
存储模组封装测试	6,118.06	5.75%	6,660.35	8.00%	7,953.02	12.10%
固态硬盘贴片费	34.01	0.03%	191.95	0.23%	13.40	0.02%
外购存储卡、存储盘主控芯片	264.51	0.25%	2,118.33	2.54%	3,137.80	4.77%
外购固态硬盘主控芯片	5,100.14	4.79%	1,777.68	2.13%	208.80	0.32%
<b>合计</b>	<b>96,196.62</b>	<b>90.39%</b>	<b>77,228.82</b>	<b>92.75%</b>	<b>63,529.52</b>	<b>96.67%</b>

### （五）行业竞争情况及发行人的竞争地位

#### 1、市场地位情况

公司凭借成熟的技术水平，开发以主控芯片为核心的移动存储管理应用方案，以主控芯片、固件方案及量产工具程序相结合，使得公司的移动存储产品在存储晶圆利用率及足容率、产品稳定性、读写速度等方面具有较强的竞争优势。

公司研发的闪存主控芯片内置电压侦测电路、多路稳压器等电路结构，同时公司的存储管理方案通过集成自主设计的 OTP 芯片 BOOT 代码扩编技术、基于硬件的实时在线编码技术、检测和错误自动纠正算法、基于硬件 ALU 算法模块上开发的动态坏块管理技术、坏块区域链式管理和集中规划算法等，增强了对 NAND Flash 的存储管理能力，提高了存储模组稳定性，降低产品成本，并适配



兼容各种主流消费电子设备。另外，公司还通过采用 Automatic Clock Gating（自动门控时钟）和 Multi Power Domain（多电源域）等降低功耗技术，达到性能和功耗的最佳平衡，同时通过使用 Mapping Table（映射表格）、擦写均衡技术、碎片整理技术和数据缓冲管理等技术，在产品应用上保持了良好的弹性，使公司的存储管理方案能够快速稳定支持不同厂商不同制程的 NAND Flash。

从存储容量角度看，根据中国闪存市场(CFM)数据，2020 年全球 NANDFlash 存储密度为 4,020 亿 GB 容量，根据 NANDFlash 产品最终形态分布特点及市场情况，固态硬盘（如 SSD、PSSD）及嵌入式存储产品（如 eMMC、UFS）等占 NANDFlash 存储密度的比例达到 85%，存储卡和存储盘等作为高性能存储产品的有效补充，主要服务于人们日常的数据存储及转移，2020 年全球存储卡、存储盘占整体 NANDFlash 的存储当量比例约为 9%。因此，对比 2020 年度公司销售存储卡、存储盘的存储当量为 11.19 亿 GB，据此测算，公司在全球存储卡和存储盘等移动存储行业的市场占有率约为 3.09%。

从销售数量角度看，根据中国闪存市场（CFM）数据，2020 年度全球存储卡销售数量约为 4.25 亿个，存储盘销售数量约为 2.41 亿个，公司存储卡、存储盘等移动存储产品 2020 年销售数量分别为 0.286 亿个和 0.118 亿个，合计约为 0.404 亿个，据此测算，2020 年度，公司存储卡产品销售数量约占全球存储卡销售总量的 6.73%，存储卡和存储盘产品合计销售数量约占全球移动存储产品销售总量的 6.07%。

## 2、同行业公司情况

目前，中国大陆及港澳台地区上市公司中暂无与公司在业务模式、产品类别等方面均可比性较强的同行业公司。具体而言，除存储原厂外，NAND Flash 存储行业内的经营公司主要可以分为两类，其中一类为向市场供应存储模组或存储品牌产品的公司如群联电子、威刚科技、台湾创见、江波龙电子和朗科科技等，另一类为专业从事闪存主控芯片设计、研发并向市场提供闪存主控芯片产品的公司，市场占有率较高的相关企业主要位于台湾地区，如慧荣科技、点序科技、安国科技等。此外，按 Flash 产品类型进一步细分，我国 A 股上市公司兆易创新为国内 NOR Flash 市场占有率排名第一的企业。

发行人设计、研发闪存主控芯片，并开发以主控芯片为核心的系统化存储管

理方案，通过适配 NAND Flash 存储晶圆，以存储模组销售的方式实现利润。公司一般不对外销售主控芯片产品，与慧荣科技、点序科技等进行主控芯片设计、研发并销售主控芯片的业务模式存在较大差异；另外，NAND Flash 存储行业市场中规模较大的模组或品牌产品厂商多以固态硬盘（如 SSD、PSSD）、嵌入式存储产品（如 eMMC、UFS）等业务为主，相关厂商一般直接从市场中采购已经市场验证的主控芯片产品，而不主要进行主控芯片的研发，业务更多侧重于存储产品后端方案开发和品牌运营。

NAND Flash 存储行业内主要有群联电子与发行人的业务模式较为相似，两者均同时进行 NAND Flash 存储晶圆采购、主控芯片研发及存储产品或模组供应，差异主要在于产品细分市场领域和企业发展阶段。其中，群联电子业务涉及各类存储产品，主要以固态硬盘业务为主，且群联电子运营并销售自有品牌的闪存主控芯片，经过 20 年的发展，群联电子已成为存储模组产品及相关主控芯片领域的全球领先企业，属于成熟期企业；而发行人产品主要为存储卡、存储盘等移动存储模组，并处于产品线逐步延伸过程中，且未营运自有产品品牌，同时，自 2016 年首颗自主研发的闪存主控芯片成功投片量产以来，发行人报告期内正处于以主控芯片为核心的闪存控制管理技术不断升级、完善和迭代的过程中，研发技术成果逐步释放，属于成长期企业。

上述同行业公司的具体情况如下：

#### （1）群联电子

群联电子股份有限公司成立于 2000 年，2004 年在台湾柜台市场挂牌，群联电子致力于研发与设计闪存控制芯片，从提供全球首颗存储盘主控芯片起家，持续深耕芯片研发，发展与闪存记忆体相关的应用系统产品，提供闪存记忆体解决方案，目前群联电子已成为存储盘、存储卡、eMMC、固态硬盘等产品及相关主控芯片领域的主要厂商。根据群联电子披露的年度报告，2020 年群联电子实现营业收入为 484.97 亿新台币，实现净利润 87.07 亿新台币。

#### （2）其他存储模组或品牌产品供应厂商

##### 1) 威刚科技

威刚科技股份有限公司成立于 2001 年 5 月，威刚科技经营初期以内存模组为主要产品线，随后着眼于闪存的应用推广，投入闪存存储器应用产品开发。目

前威刚主要产品线业已涵盖 DRAM 及 Flash 内存应用领域，在内存模组及闪存模组市场具有较强的竞争优势。根据威刚科技披露的年度报告，2020 年威刚科技实现营业收入为 322.27 亿新台币，实现净利润 13.61 亿新台币。

#### 2) 台湾创见

创见资讯股份有限公司创立于 1988 年，总部位于台湾台北，2001 年在台湾上市，产品包含各式闪存卡、U 盘、外接式硬盘、固态硬盘、内存模块组、多媒体产品、读卡器、数码周边产品与工控类产品。台湾创见在台湾、美国、英国、德国、荷兰、日本、韩国、中国大陆和中国香港均成立了销售办事处，制造工厂位于台北和上海。根据台湾创见披露的年度报告，2020 年台湾创见实现营业收入为 114.47 亿新台币，实现净利润 11.98 亿新台币。

#### 3) 江波龙电子

深圳市江波龙电子股份有限公司成立于 1999 年，是一家聚焦 NAND 闪存应用和存储软件开发的国内存储企业，旗下拥有深耕行业应用的嵌入式存储品牌 FORESEE 和高端消费类存储品牌 Lexar 雷克沙。根据江波龙电子披露的招股说明书，2020 年江波龙电子实现营业收入为 72.76 亿元，实现净利润 2.76 亿元。

#### 4) 朗科科技

深圳市朗科科技股份有限公司（股票代码：300042），成立于 1999 年，是国内专业存储上市公司，并运营自有品牌。朗科科技主要业务为闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、存储卡等的研发、生产和销售，以及相关专利运营。朗科科技拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及专利。朗科科技产品运营通过从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售获取收入。根据朗科科技披露的年度报告，2020 年朗科科技实现营业收入为 14.91 亿元，实现净利润 0.71 亿元。

### (3) 闪存主控芯片供应厂商：

#### 1) 慧荣科技

慧荣科技(Silicon Motion Technology Corp.)于 1995 年成立于美国加州矽谷，2002 年与台湾的慧亚科技合并后更名为慧荣科技，总部设于台湾新竹，目前在台湾、大陆、美国、韩国、日本设有研发及营运团队。慧荣科技于 2005 年 6 月在美国 Nasdaq 上市，是台湾第一家赴美挂牌的 IC 设计公司。

慧荣科技是 NAND Flash 主控芯片的全球领导者，拥有超过 20 年的设计开发经验，为 SSD 及其他固态存储装置提供领先业界的高性能存储解决方案，应用范围包括智能手机、个人电脑、资料中心、商业及工控应用。根据慧荣科技披露的年度报告，2020 年度慧荣科技营业收入达到 5.40 亿美元，实现净利润 0.80 亿美元。

## 2) 点序科技

点序科技股份有限公司成立于 2008 年 2 月，为闪存控制芯片供货商，产品包含 SD/MicroSD 控制芯片、USB 控制芯片、eMMC 控制芯片以及 SSD 控制芯片等。点序科技在存储卡、存储盘主控芯片的开发与量产领域积累了丰富的经验，并成功应用并推出其新开发的 eMMC5.1、SATA III SSD 等主控芯片，为客户提供更完整的产品方案选择。根据点序科技披露的年度报告，2020 年点序科技营业收入达到 9.40 亿新台币，实现净利润 0.29 亿新台币。

## 3) 安国科技

安国国际科技（ALCOR MICRO,CORP.）于 1999 年正式在台湾成立，其拥有多样专业计算机外设控制 IC 产品，主要可分为输出装置暨多媒体图像处理装置应用和储存装置应用，分别提供人性化接口输入输出装置系列控制芯片、网桥控制芯片、网络安全保护装置、网络摄影机控制芯片等多媒体应用 IC 系列控制芯片以及提供可携带式闪存系列控制芯片、固态硬盘控制芯片等。根据安国科技披露的年度报告，2020 年安国科技营业收入达到 11.49 亿新台币，实现净利润为 5.4 万新台币。

## (4) NOR Flash 产品供应商兆易创新

北京兆易创新科技股份有限公司（股票代码：603986），成立于 2005 年，是一家领先的无晶圆厂半导体公司，致力于开发先进的存储器技术和 IC 解决方案，2016 年 8 月在上海证券交易所上市。在中国市场，兆易创新的 SPI NOR Flash 市场占有率为第一，同时也是全球排名前三的供应商之一。根据兆易创新披露的年度报告，2020 年兆易创新实现营业收入 44.97 亿元，实现净利润 8.80 亿元。

# 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

## (一) 固定资产

### 1、主要固定资产情况

公司主要的固定资产为办公及开展经营活动所使用的电子及其他设备、运输设备等截至 2021 年 12 月 31 日，公司的固定资产状况如下表所示：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	减值准备	净额	成新率
机器设备	681.14	50.28	-	630.86	92.62%
电子及其他设备	2,919.36	802.56	-	2,116.81	72.51%
运输设备	144.08	91.71	-	52.37	36.35%
合计	3,744.58	944.54	-	2,800.04	74.78%

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的主要设备情况如下表所示：

序号	设备名称	数量(台/套)	原值(万元)	净值(万元)	成新率	分布情况
1	TW2983A 光罩	1	7.62	6.77	88.85%	加工商处 / 发行人
2	TW8381B 光罩	1	338.06	274.73	81.27%	加工商处 / 发行人
3	TW2981A 光罩	1	186.75	133.62	71.55%	加工商处 / 发行人
4	TW2980A 光罩	1	88.43	33.82	38.24%	加工商处 / 发行人
5	TW8380A 光罩	1	88.43	58.80	66.49%	加工商处 / 发行人
6	TW9080A 光罩	1	98.60	23.66	24.00%	加工商处 / 发行人
7	TW2880 光罩	1	88.75	0	0	加工商处 / 发行人
8	TW311X 光罩	1	70.85	8.03	11.33%	加工商处 / 发行人
9	高速自动贴片机	2	194.69	171.57	88.13%	大浪分公司
10	中速贴片机	1	63.94	56.35	88.13%	大浪分公司
11	SPI 检测设备	1	24.78	21.84	88.13%	大浪分公司
12	AOI 检测设备	1	23.89	21.06	88.13%	大浪分公司
13	日东双轨 10 温区回流焊机	1	21.68	19.11	88.13%	大浪分公司
14	铣刀式自动分板机	1	15.04	13.26	88.13%	大浪分公司
15	全自动印刷机	1	11.68	10.29	88.13%	大浪分公司
16	高速自动贴片机	2	191.25	186.71	97.63%	大浪分公司

17	中速贴片机	1	44.25	43.19	97.63%	大浪分公司
18	SPI 检测设备	1	23.01	22.46	97.63%	大浪分公司
19	自动光学检测仪 A01	1	22.12	21.60	97.63%	大浪分公司
20	全自动锡膏印刷机	1	11.33	11.06	97.63%	大浪分公司
21	自动测 DIE 机	8	232.21	188.09	81.00%	大浪分公司
22	自动测 DIE 机	12	348.32	315.23	90.50%	大浪分公司
23	自动测 DIE 机	10	290.27	276.48	95.25%	大浪分公司
24	晶圆测试升降测试台	50	66.28	32.70	49.34%	大浪分公司
25	测试电脑	550	68.13	58.42	85.75%	大浪分公司
26	120 口 TF 卡手摇测试架	70	40.64	39.99	98.4%	大浪分公司
	<b>合 计</b>	-	<b>2,661.00</b>	<b>2,048.84</b>	-	-

## 2、房屋所有权情况

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人未拥有房屋所有权及土地使用权，发行人生产经营场所均为租赁使用，主要情况如下：

序号	房屋坐落地点	出租人	承租人	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租金	用途
1	深圳市福田区中康路136号深圳新一代产业园1栋24层、25层	深圳市福田区政府物业管理中心	德明利	3,940.66	2020.9.1至2025.8.31	270,920.38元/月，第二年起递增3%（2020.9.1至2021.02.28为免租期）	办公
	深圳市福田区中康路136号深圳新一代产业园1栋23层		德明利	1,970.33	2021.05.10至2026.05.09	2021.08.10至2022.05.09月租金为133,982.44元/月，第二年度起租金为276,003.83元/月，后续年度每年递增3%（2021.05.10至2021.08.09为免租期）	办公
2	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路387号1栋3层	深圳豪迈电器有限公司	德明利	2,163.5	2020.5.1至2024.12.31	74,268.50元/月（另电梯费800元/月）	厂房与宿

	第3栋宿舍 508-511, 第4栋 宿舍220、221、 420、421			278.40 (共8间)			舍
	深圳市龙华区 大浪街道浪口 社区华霆路387 号1栋4层			2,163.5	2020.10.16 至 2024.12.31	79,184.00/月 (另电梯费800 元/月)	厂房
	深圳市龙华区 大浪街道浪口 社区华霆路387 号1栋5层			2,163.5	2022.01.01 至 2022.12.31	79,184.00元/月 (另电梯费800 元/月)	厂房
	深圳市龙华区 大浪街道豪迈 高新技术园宿 舍楼2504、 2505、2506、 2507 号房			123.20 (共4间)	2020.05. 1-2024.12.31	3,400元/月	宿舍
	深圳市龙华区 大浪街道豪迈 高新技术园宿 舍楼2508、 2509、3107、 3503、3504号房			160.42 (共5间)	2020.07.20-2 024.12.31	4,250元/月	宿舍
	深圳市龙华区 大浪街道豪迈 高新技术园宿 舍楼3607、 3608、3609、 3610、3611号房			164.70 (共5间)	2020.10.14-2 024.12.31	4,250元/月	宿舍
3	香港九龙新蒲 岗五芳街10号 新宝中心8楼02 室	Haskins Investm ents Limited	香港源 德	1,119.00 (平方 呎)	2021.06.01 至 2023.05.31	15,000港元/月 (另管理费 2,509港元/月)	工厂
	1,267.00 (平方 呎)			2020.12.08 至 2023.01.31	16,500港元/月; (另管理费 2,845港元/月)	工厂	
4	深圳市福田区 福保街道福保 社区红柳道2号 顺丰工业厂房1 层B125房	深圳市 福田区 政府物 业管理 中心	德明利 光电	1,359.22	2020.10.15 至 2025.10.14	146,116.15元/ 月, 第二年起递 增5% (2020.10.15至 2021.1.14为免 租期)	厂房

5	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街158号2栋1单元2008单位	成都筑梦之星科技有限公司	德明利	158.00	2021.09.08 至 2022.06.07	3,160元/月（另物业管理费3,950元/月，办公室服务费12,640元/月）	办公
	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街158号2栋1单元2010单位	成都筑梦之星科技有限公司	德明利	136.00	2021.11.25 至 2022.06.07	2,720元/月（另物业管理费3,400元/月，办公室服务费10,880元/月）	办公

上述第 1 项租赁物业目前尚未取得房屋权属证书，其为政府自持物业，根据深圳市福田区政府物业管理中心出具的《租赁证明》，公司所承租深圳市福田区新一代产业园 1 栋 23-25 层，由产权人深圳市福田区政府物业管理中心出租给公司办公使用。公司实际控制人李虎、田华已出具承诺，若在房屋租赁合同有效期内，因房屋租赁法律瑕疵或因抵押等权利限制致使公司搬迁等遭受损失，公司实际控制人将承担相关搬迁损失。

发行人及其分公司、控股子公司租赁上述房屋的租金系参考当地同类房产的市场价格，平等协商确定。发行人及其分公司、控股子公司租赁上述房屋的租金定价符合市场情况和实际使用情况，定价公允。上述出租方与发行人及其关联方不存在关联关系，亦不存在利益输送情形。

## （二）无形资产

公司无形资产主要包括专利、商标、软件著作权、集成电路布图设计专有权等。具体情况如下：

### 1、专利

截至本招股说明书摘要签署之日，公司共取得 110 项专利，具体情况如下：

序号	权利人	专利名称	类型	专利号	申请日	专利权期限	取得方式	他项权利
1	发行人	记忆模块动态备份管理系统及方法	发明专利	ZL200810217177.1	2008.10.31	20 年	原始取得	无
2	发行人	一种闪存接口信息的实时解析方法和系统	发明专利	ZL201511026644.9	2015.12.31	20 年	原始取得	无
3	发行人	一种抓取闪存有效信号的方法及系统以及逻辑分析仪	发明专利	ZL201511020067.2	2015.12.31	20 年	原始取得	无



4	发行人	基于爬山算法的触控屏抗干扰方法、触控装置及移动终端	发明专利	ZL201811087120.4	2018.09.17	20年	原始取得	无
5	发行人	一种用于大尺寸触摸屏的触摸屏传感器及触摸识别方法	发明专利	ZL201910414038.6	2019.05.17	20年	原始取得	无
6	发行人	一种命令超时处理方法及系统	发明专利	ZL201810603200.4	2018.06.12	20年	原始取得	无
7	发行人	一种数据存储方法及存储器	发明专利	ZL201811123529.7	2018.09.26	20年	原始取得	无
8	发行人	一种基于区域镜像的角落触控识别方法、装置及移动终端	发明专利	ZL201811512838.3	2018.12.11	20年	原始取得	无
9	发行人	一种存储数据的动态回收处理方法及存储装置	发明专利	ZL201811626099.0	2018.12.28	20年	原始取得	无
10	发行人	一种三指同轴拆点的判断方法、触控屏及触控显示装置	发明专利	ZL201811589736.1	2018.12.25	20年	原始取得	无
11	发行人	一种三指同轴拆点合并的方法、触控装置及触控显示装置	发明专利	ZL201811590755.6	2018.12.25	20年	原始取得	无
12	发行人	触控识别中三指同轴拆点的判断方法、触控屏及电子设备	发明专利	ZL201811590754.1	2018.12.25	20年	原始取得	无
13	发行人	一种触摸屏带水与诡点的区分方法、触摸屏及移动终端	发明专利	ZL201811554930.6	2018.12.18	20年	原始取得	无
14	发行人	一种基于可移动存储的无感控制方法和系统以及设备	发明专利	ZL201910684007.2	2019.07.26	20年	原始取得	无
15	发行人	一种闪存热数据识别方法	发明专利	ZL201811085164.3	2018.09.18	20年	原始取得	无
16	发行人	用于多点电容触控的坐标计算方法、触控装置及移动终端	发明专利	ZL201811124316.6	2018.09.26	20年	原始取得	无
17	发行人	一种触控识别方法、装置及触控显示装置	发明专利	ZL201810871799.X	2018.08.02	20年	原始取得	无
18	发行人	一种存储设备测试和自动分BIN的方法、装置以及设备	发明专利	ZL201910867062.5	2019.09.12	20年	原始取得	无

19	发行人	一种 ECC 数据存储方法, 系统及存储介质	发明专利	ZL201810507105.4	2018.05.24	20 年	原始取得	无
20	发行人	基于电容触控的二次区域查找方法及触控装置、移动终端	发明专利	ZL201811269541.9	2018.10.29	20 年	原始取得	无
21	发行人	一种对存储设备进行测试的方法和装置以及设备	发明专利	ZL201910314783.3	2019.04.18	20 年	原始取得	无
22	发行人	基于可编程逻辑器件的加密方法及系统	发明专利	ZL201610988601.7	2016.11.9	20 年	原始取得	无
23	发行人	一种 LPDDR 基板设计方法、LPDDR 基板和电子设备	发明专利	ZL202010056038.6	2020.01.17	20 年	原始取得	无
24	发行人	一种高速的闪存模拟器及其模拟方法	发明专利	ZL201810532014.6	2018.05.25	20 年	原始取得	无
25	发行人	一种触控识别方法及触控装置	发明专利	ZL201810871840.3	2018.08.02	20 年	原始取得	无
26	发行人	一种触控识别方法、装置及触控显示装置	发明专利	ZL201810871811.7	2018.08.02	20 年	原始取得	无
27	发行人	一种触控屏短路测试方法、触控屏及移动终端	发明专利	ZL201811295878.7	2018.11.01	20 年	原始取得	无
28	发行人	一种两指按压重合区域识别方法、触控装置及移动终端	发明专利	ZL201811269543.8	2018.10.29	20 年	原始取得	无
29	德明利光电	基于区域镜像的触控坐标计算方法、触控装置及移动终端	发明专利	ZL201811512840.0	2018.12.11	20 年	从发行人受让取得	无
30	德明利光电	一种随机种子保存的方法、装置、存储介质及计算机设备	发明专利	ZL202010028276.6	2020.01.10	20 年	从发行人受让取得	无
31	发行人	一种数据存储方法、存储设备及存储系统	发明专利	ZL201810681842.6	2018.06.27	20 年	原始取得	无
32	发行人	一种触控识别方法、装置及触控显示装置	发明专利	ZL201810871800.9	2018.08.02	20 年	原始取得	无
33	发行人	一种基于区域镜像的触控识别方法、装置及触控显示装置	发明专利	ZL201811512862.7	2018.12.11	20 年	原始取得	无
34	发行人	一种载货监测装置及系统	实用新型	ZL201521136584.1	2015.12.31	10 年	原始取得	无
35	发行人	一种载货防盗监测装置及系统	实用新型	ZL201521137514.8	2015.12.31	10 年	原始取得	无

36	发行人	一种 USB 智能组合插座装置	实用新型	ZL201521140179.7	2015.12.31	10 年	原始取得	无
37	发行人	一种双层导电层的触摸屏传感器及触摸屏	实用新型	ZL201621208961.2	2016.11.09	10 年	原始取得	无
38	发行人	一种电容折叠屏传感器及电容折叠屏	实用新型	ZL201820827554.2	2018.05.30	10 年	原始取得	无
39	发行人	一种电容式折叠屏传感器及电容式折叠屏	实用新型	ZL201820826738.7	2018.05.30	10 年	原始取得	无
40	发行人	一种 TF 卡存储器组合测试架	实用新型	ZL201820909334.4	2018.06.12	10 年	原始取得	无
41	发行人	一种多功能转接设备	实用新型	ZL201820939893.X	2018.06.15	10 年	原始取得	无
42	发行人	一种用于快速烧录程序的设备	实用新型	ZL201820967075.0	2018.06.21	10 年	原始取得	无
43	发行人	一种电阻电容收纳盒	实用新型	ZL201821019616.3	2018.06.28	10 年	原始取得	无
44	发行人	一种触控面板及触控显示装置	实用新型	ZL201821066901.0	2018.07.06	10 年	原始取得	无
45	发行人	一种触控面板及触控显示装置	实用新型	ZL201821519324.6	2018.09.17	10 年	原始取得	无
46	发行人	一种手机用的便携式外接通话降噪扩音模块	实用新型	ZL201821252902.4	2018.08.06	10 年	原始取得	无
47	发行人	一种多接口的 USB 转发设备	实用新型	ZL201821375267.9	2018.08.24	10 年	原始取得	无
48	发行人	一种用于触控屏测试的供电装置及系统	实用新型	ZL201821519322.7	2018.09.17	10 年	原始取得	无
49	发行人	一种分体电视	实用新型	ZL201821462227.8	2018.09.07	10 年	原始取得	无
50	发行人	一种触控装置以及移动终端	实用新型	ZL201821526389.3	2018.09.17	10 年	原始取得	无
51	发行人	一种触摸面板及显示装置	实用新型	ZL201821630446.2	2018.10.08	10 年	原始取得	无
52	发行人	一种触控装置及移动终端	实用新型	ZL201821630935.8	2018.10.08	10 年	原始取得	无
53	发行人	通用单片机 SD 量产架	实用新型	ZL201821675373.9	2018.10.16	10 年	原始取得	无
54	发行人	一种触控显示模组	实用新型	ZL201821688382.1	2018.10.18	10 年	原始取得	无
55	发行人	一种触碰式显示面板	实用新型	ZL201821688344.6	2018.10.18	10 年	原始取得	无
56	发行人	一种多功能触控显示屏	实用新型	ZL201821688490.9	2018.10.18	10 年	原始取得	无

57	发行人	一种便携式储存器	实用新型	ZL201821688484.3	2018.10.18	10年	原始取得	无
58	发行人	一种硬盘存储装置	实用新型	ZL201821688445.3	2018.10.18	10年	原始取得	无
59	发行人	一种自容式触控面板及触控显示装置	实用新型	ZL201821837018.7	2018.11.08	10年	原始取得	无
60	发行人	一种存储器	实用新型	ZL201822052427.2	2018.12.07	10年	原始取得	无
61	发行人	一种自电容触摸屏及电子设备	实用新型	ZL201822244203.1	2018.12.28	10年	原始取得	无
62	发行人	用于快速存储器质量检测的封闭式存储器成品烘烤设备	实用新型	ZL201822115399.4	2018.12.17	10年	原始取得	无
63	发行人	一种磁吸数据线及电连接设备	实用新型	ZL201822243880.1	2018.12.28	10年	原始取得	无
64	发行人	一种触摸屏银浆丝印通用网版	实用新型	ZL201822253477.7	2018.12.29	10年	原始取得	无
65	发行人	一种自容触控面板	实用新型	ZL201822269094.9	2018.12.29	10年	原始取得	无
66	发行人	一种单层互容式触控面板	实用新型	ZL201822274144.2	2018.12.29	10年	原始取得	无
67	发行人	一种自容触控面板	实用新型	ZL201822277354.7	2018.12.29	10年	原始取得	无
68	发行人	一种自容窄边框触控面板	实用新型	ZL201822276724.5	2018.12.29	10年	原始取得	无
69	发行人	一种自容触控面板	实用新型	ZL201822269048.9	2018.12.29	10年	原始取得	无
70	发行人	一种板材切割钻孔设备	实用新型	ZL201822277352.8	2018.12.29	10年	原始取得	无
71	发行人	一种触控屏及电子设备	实用新型	ZL201920045801.8	2019.01.09	10年	原始取得	无
72	发行人	一种触控屏短路检测装置及系统	实用新型	ZL201920028232.6	2019.01.08	10年	原始取得	无
73	发行人	一种触摸屏传感器及触摸屏	实用新型	ZL201920372597.0	2019.03.22	10年	原始取得	无
74	发行人	一种用于大尺寸触摸屏的传感器及触摸屏	实用新型	ZL201920372594.7	2019.03.22	10年	原始取得	无
75	发行人	一种触摸屏	实用新型	ZL201920421921.3	2019.03.30	10年	原始取得	无
76	发行人	自容触摸屏	实用新型	ZL201920421926.6	2019.03.30	10年	原始取得	无
77	发行人	一种自电容屏幕的精度检测机构	实用新型	ZL201920421919.6	2019.03.30	10年	原始取得	无

78	发行人	一种大尺寸触摸屏的触控系统	实用新型	ZL201920803679.6	2019.05.30	10年	原始取得	无
79	发行人	用于快速存储器质量检测的开放式存储器晶圆烘烤设备	实用新型	ZL201822122645.9	2018.12.17	10年	原始取得	无
80	发行人	一种多功能复合容器	实用新型	ZL201920370820.8	2019.03.21	10年	原始取得	无
81	发行人	一种基于通用闪存存储器的闪存装置以及设备	实用新型	ZL201920611943.6	2019.04.28	10年	原始取得	无
82	发行人	一种芯片测试架	实用新型	ZL201921303984.5	2019.08.08	10年	原始取得	无
83	发行人	一种适用于U盘测试分析架	实用新型	ZL201920657624.9	2019.05.08	10年	原始取得	无
84	发行人	一种适用于TF卡测试分析架	实用新型	ZL201920655730.3	2019.05.08	10年	原始取得	无
85	发行人	一种压针式U盘开卡测试架	实用新型	ZL201920766484.9	2019.05.24	10年	原始取得	无
86	发行人	一种双层互容式触控屏	实用新型	ZL201921206960.8	2019.07.26	10年	原始取得	无
87	发行人	多通道驱动装置及触控面板	实用新型	ZL201921425224.1	2019.08.29	10年	原始取得	无
88	发行人	触摸屏抗干扰控制的装置及触控面板	实用新型	ZL201921429529.X	2019.08.29	10年	原始取得	无
89	发行人	一种触摸屏	实用新型	ZL201921438384.X	2019.08.29	10年	原始取得	无
90	发行人	一种触控驱动装置及触控面板	实用新型	ZL201921441155.3	2019.08.29	10年	原始取得	无
91	发行人	一种整合USB2.0和USB3.0通讯芯片的测试电路以及测试架	实用新型	ZL201921521474.5	2019.09.12	10年	原始取得	无
92	发行人	一种兼容移动固态硬盘的结构及移动固态硬盘	实用新型	ZL201921598471.1	2019.09.23	10年	原始取得	无
93	发行人	一种基于UFS的微型TYPE-C移动固态硬盘	实用新型	ZL201921583593.3	2019.09.23	10年	原始取得	无
94	发行人	一种通用串行总线集线装置和通用串行总线集线设备	实用新型	ZL201921687360.8	2019.10.10	10年	原始取得	无
95	发行人	一种具备大容量存储功能的SIM卡	实用新型	ZL201922402336.1	2019.12.27	10年	原始取得	无

96	发行人	一种 SIM 卡和 SD 卡二合一控制芯片	实用新型	ZL201922402262.1	2019.12.27	10 年	原始取得	无
97	发行人	一种无痕测试装置	实用新型	ZL202020002534.9	2020.01.02	10 年	原始取得	无
98	发行人	一种存储产品的高低温试验的测试装置	实用新型	ZL202020244000.7	2020.03.02	10 年	原始取得	无
99	发行人	一种转接板	实用新型	ZL202021021837.1	2020.06.06	10 年	原始取得	无
100	发行人	一种基于 UFS 的大容量存储 SIM 卡	实用新型	ZL202020707281.5	2020.04.30	10 年	原始取得	无
101	发行人	一种透明显示屏模组及透明显示屏	实用新型	ZL202022176485.3	2020.09.28	10 年	原始取得	无
102	发行人	一种外挂 CC 逻辑功能的移动固态硬盘电路及移动固态硬盘	实用新型	ZL202022263104.5	2020.10.13	10 年	原始取得	无
103	发行人	闪存封装模块 (Type-C)	外观设计	ZL201530568776.9	2015.12.31	10 年	原始取得	无
104	发行人	多功能转接设备	外观设计	ZL201830307920.7	2018.06.15	10 年	原始取得	无
105	发行人	电容电阻收纳盒	外观设计	ZL201830341129.8	2018.06.28	10 年	原始取得	无
106	发行人	存储器吸放笔	外观设计	ZL201830771184.0	2018.12.29	10 年	原始取得	无
107	发行人	存储器成品烘烤设备 (封闭式)	外观设计	ZL201830731865.4	2018.12.17	10 年	原始取得	无
108	发行人	存储器晶圆烘烤设备 (开放式)	外观设计	ZL201830732268.3	2018.12.17	10 年	原始取得	无
109	发行人	移动固态存储硬盘 (微型)	外观设计	ZL201930558525.0	2019.10.14	10 年	原始取得	无
110	发行人	大容量 SIM 卡 (基于 UFS 存储介质)	外观设计	ZL202030192437.6	2020.04.30	10 年	原始取得	无

## 2、商标

截至本招股说明书摘要签署之日，公司主要拥有如下商标：

序号	权利人	商标	注册号	类别	有效期至	取得方式	他项权利
1	发行人	<b>德名利</b>	39631678	36	2030.04.13	原始取得	无
2	发行人	<b>德名利</b>	39627331	37	2030.04.06	原始取得	无
3	发行人	<b>德名利</b>	39624242	7	2030.04.06	原始取得	无

4	发行人	德名利	39617884	9	2030.04.06	原始取得	无
5	发行人	德名利	39607228	42	2030.09.20	原始取得	无
6	发行人	德明利	44595012	40	2030.10.27	原始取得	无
7	发行人	PSSD	39621849	42	2030.09.13	原始取得	无
8	发行人	PSSD	39617982	35	2030.10.06	原始取得	无
9	发行人	德明利	44589232	37	2030.12.27	原始取得	无
10	发行人	德明利	44578683	7	2031.02.20	原始取得	无
11	发行人		47018580	9	2031.03.06	原始取得	无
12	发行人	德明利	44569785	42	2031.03.27	原始取得	无
13	发行人	德明利	49282629	9	2031.04.06	原始取得	无
14	发行人	德明利	49287386	36	2031.06.06	原始取得	无

### 3、软件著作权

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人及其子公司共取得 72 项软件著作权，均为原始取得，具体情况如下表所示：

序号	著作权人	名称	类型	登记号	有效期限	取得方式
1	发行人	德名利 U 盘主控量产分区加密软件 V2.06	计算机软件	2010SR074878	2009.10.20-2059.12.31	原始取得
2	发行人	TW8070 闪存控制存储产品量产软件[简称：TW8070-MP-Tool]V1.0	计算机软件	2016SR172433	2014.03.01-2064.12.31	原始取得
3	发行人	TW8090 闪存控制存储产品量产软件[简称：TW8090-MP-Tool]V1.0	计算机软件	2016SR172523	2014.09.28-2064.12.31	原始取得
4	发行人	基于高性能互容 IC 的多点触摸触控嵌入式系统软件 V1.0	计算机软件	2016SR172424	2015.03.20-2065.12.31	原始取得
5	发行人	高速存储模组引导软件 V1.0	计算机软件	2016SR172086	2015.07.01-2065.12.31	原始取得
6	发行人	智能安全存储模组引	计算机软件	2016SR172428	2015.08.30-2065.12.31	原始

		导程序软件 V1.0				取得
7	发行人	TW2880 用户修改设备工作参数工具软件[简称: TW2880 用户工具]V1.1	计算机软件	2016SR172526	2015.11.25-2065.12.31	原始取得
8	发行人	电容式触摸屏手势软件 V1.1	计算机软件	2016SR171836	2015.11.25-2065.12.31	原始取得
9	发行人	配置量产闪存支持信息软件[简称: CPIS]V1.029	计算机软件	2016SR171812	2015.11.25-2065.12.31	原始取得
10	发行人	文件拷贝对比软件 V1.00	计算机软件	2017SR618109	2016.08.15-2066.12.31	原始取得
11	发行人	量产工具配套验证码生成软件 V1.0	计算机软件	2017SR617887	2017.08.25-2067.12.31	原始取得
12	发行人	量产工具固件配套函数头文件生产软件 V1.0	计算机软件	2017SR617547	2017.01.25-2067.12.31	原始取得
13	发行人	非易失电可编程只读存储模组引导程序软件 V1.0	计算机软件	2017SR617552	2017.08.25-2067.12.31	原始取得
14	发行人	FingerToucher 软件 1.1.1.0	计算机软件	2018SR386761	2018.03.20-2068.12.31	原始取得
15	发行人	德名利非安装包 C#工具软件 V1.0	计算机软件	2018SR642641	2018.04.01-2068.12.31	原始取得
16	发行人	德名利触摸面板量产工具软件的样品分析功能模块 V1.0	计算机软件	2018SR746146	2018.06.20-2068.12.31	原始取得
17	发行人	德名利触摸面板测试工具软件 V1.0	计算机软件	2018SR638182	2018.06.20-2068.12.31	原始取得
18	发行人	德名利量产工具配套高级格式化功能模块软件 V1.0	计算机软件	2018SR701794	2018.07.01-2068.12.31	原始取得
19	发行人	功能盘解密功能配套软件[简称: Display Disk]V1.0	计算机软件	2019SR1164618	2018.07.01-2068.12.31	原始取得
20	发行人	德名利数据显示界面测试软件 V1.0	计算机软件	2018SR702162	2018.07.02-2068.12.31	原始取得
21	发行人	德名利外部辅助自动点击软件 V1.0	计算机软件	2019SR0412550	2018.07.10-2068.12.31	原始取得
22	发行人	德名利记录量产数量软件 V1.0	计算机软件	2018SR722149	2018.07.20-2068.12.31	原始取得
23	发行人	德名利下载显示界面软件 V1.0	计算机软件	2018SR732260	2018.07.24-2068.12.31	原始取得



24	发行人	德名利量产工具配套功能盘实现模块软件 V1.0	计算机软件	2019SR041177 2	2018.08.10-2068.12.31	原始取得
25	发行人	量产工具配套快速扩展格式化功能模块 V1.0	计算机软件	2018SR852958	2018.08.20-2068.12.31	原始取得
26	发行人	触摸屏调试软件 V1.0	计算机软件	2018SR104372 1	2018.09.28-2068.12.31	原始取得
27	发行人	触摸屏调试服务软件 V1.0	计算机软件	2018SR981555	2018.09.30-2068.12.31	原始取得
28	发行人	触摸面板量产工具软件参数分类载入功能软件 V1.0	计算机软件	2019SR013791 5	2018.11.20-2068.12.31	原始取得
29	发行人	德名利多点电容触控系统 V1.0	计算机软件	2018SR638162	未发表	原始取得
30	发行人	德名利基于三段拉伸的边缘处理模块软件 V1.0	计算机软件	2018SR732270	未发表	原始取得
31	发行人	德名利量产工具配套高级镜像文件写入功能模块软件 V1.0	计算机软件	2018SR100684 4	未发表	原始取得
32	发行人	德名利报点显示界面软件 V1.0	计算机软件	2018SR702064	未发表	原始取得
33	发行人	18S056DML 德名利适应环境变化的基值处理模块 V1.0	计算机软件	2018SR749555	未发表	原始取得
34	发行人	18S057DML 德名利基于平整度的基值处理模块 V1.0	计算机软件	2018SR749540	未发表	原始取得
35	发行人	德名利电容触控的触摸区域查找模块软件 [简称：区域查找模块]V1.0	计算机软件	2018SR906578	未发表	原始取得
36	发行人	德名利电容触控的坐标配对模块软件[简称：坐标配对模块]V1.0	计算机软件	2018SR906585	未发表	原始取得
37	发行人	德名利电容触控的触摸去抖模块软件 V1.0	计算机软件	2018SR907132	未发表	原始取得
38	发行人	德名利多点电容触控的可变权值的坐标计算模块软件 V1.0	计算机软件	2018SR906593	未发表	原始取得
39	发行人	德名利计算并拢两指坐标的坐标计算模块	计算机软件	2018SR906619	未发表	原始取得

		软件 V1.0				
40	发行人	德名利判断两指并拢的按压区域判断模块软件[简称:两指并拢坐标计算模块]V1.0	计算机软件	2018SR906628	未发表	原始取得
41	发行人	德名利整机无线通讯模块软件 V1.0	计算机软件	2018SR906635	未发表	原始取得
42	发行人	德名利基于 CAD 的触摸屏单层多点传感器生成工具软件 V1.0	计算机软件	2018SR906643	未发表	原始取得
43	发行人	德名利基于内存映射到软件界面模块 V1.0	计算机软件	2018SR906658	未发表	原始取得
44	发行人	基于分段拉伸的线性边缘处理模块 V1.0	计算机软件	2018SR103051 1	未发表	原始取得
45	发行人	灵活适应坐标协议的触控通信软件 V1.0	计算机软件	2018SR104371 4	未发表	原始取得
46	发行人	TechwinUtility 调试软件 V1.0	计算机软件	2019SR109838 3	2019.04.10-2069.12.31	原始取得
47	发行人	固件下载工具软件 V1.0	计算机软件	2019SR109830 7	2019.05.31-2069.12.31	原始取得
48	发行人	德名利电容触控的坐标轨迹平滑处理模块软件 V1.0	计算机软件	2019SR040804 5	未发表	原始取得
49	发行人	德名利电容触控的 LCD 干扰消除模块软件 V1.0	计算机软件	2019SR041134 0	未发表	原始取得
50	发行人	德名利适用于窄边框触摸屏的边缘数据处理模块软件[简称:边缘数据处理模块]V1.0	计算机软件	2019SR040873 7	未发表	原始取得
51	发行人	德名利触摸屏坐标计算模块软件 V1.0	计算机软件	2019SR0411131	未发表	原始取得
52	发行人	量产工具配套序列号格式化功能模块软件 V1.0	计算机软件	2019SR005647 5	未发表	原始取得
53	发行人	触摸屏 USB 调试软件 V1.0	计算机软件	2019SR109888 7	未发表	原始取得
54	发行人	临时文件清除工具软件 V1.0	计算机软件	2019SR109895 0	未发表	原始取得
55	发行人	德名利基于 CAD 的触摸屏单层自容传感器生成工具软件 V1.0	计算机软件	2020SR044630 3	未发表	原始取得
56	发行人	德名利基于电容触控	计算机软件	2020SR066723	未发表	原始

		的智能手机按键处理模块软件 V1.0		9		取得
57	发行人	特定错误类型 Log 分析软件 V1.0	计算机软件	2021SR1310689	2021.06.19-2071.12.31	原始取得
58	发行人	量产闪存失败信息软件 V1.0	计算机软件	2021SR1314733	2021.07.02-2071.12.31	原始取得
59	发行人	激光码解码软件 V1.0	计算机软件	2021SR1446399	2021.07.05-2071.12.31	原始取得
60	发行人	底层数据转码显示软件 V1.0	计算机软件	2021SR1893183	2021.06.02-2071.12.31	原始取得
61	发行人	INI 初始化文件编辑软件 V1.0	计算机软件	2022SR0084042	2021.11.24-2071.12.31	原始取得
62	发行人	专用开卡电路板电流检测软件	计算机软件	2022SR0156592	未发表, 因技术保护层 面原因未公开	原始取得
63	发行人	移动存储设备数据读写速度监测软件	计算机软件	2022SR0156591	未发表, 因技术保护层 面原因未公开	原始取得
64	发行人	行车记录仪数据记录模拟测试软件	计算机软件	2022SR0156593	未发表, 因技术保护层 面原因未公开	原始取得
65	发行人	行车记录仪日志信息筛选软件	计算机软件	2022SR0156594	未发表, 因技术保护层 面原因未公开	原始取得
66	发行人	模拟测试预设项目流程测试软件	计算机软件	2022SR0156619	未发表, 因技术保护层 面原因未公开	原始取得
67	德明利光电	多通道光模块电流源测试软件V1.0	计算机软件	2021SR1446487	2021.11.05-2071.12.31	原始取得
68	德明利光电	基于CWDM多通道 光模块测试软件	计算机软件	2021SR1446491	2021.01.20-2071.12.31	原始取得
69	德明利光电	以太网光模块数字传输系统软件	计算机软件	2021SR1446462	2020.11.10-2070.12.31	原始取得
70	德明利光电	基于XFP光模块的自动化调测软件	计算机软件	2021SR1496452	2021.04.20-2071.12.31	原始取得
71	德明利光电	SFP VCSEL光模块通讯底层软件	计算机软件	2021SR1499749	2021.05.20-2071.12.31	原始取得
72	德明利光电	M0219x Control光发模块调测软件	计算机软件	2021SR1496484	2021.06.25-2071.12.31	原始取得

#### 4、集成电路布图设计专有权

截至本招股说明书摘要签署之日, 发行人共拥有 6 项集成电路布图设计专有权登记证书, 具体情况如下表所示:

序号	布图设计名称	登记号	取得方式	申请日
1	TW2880 存储卡控制芯片	BS.185559557	自主取得	2018.07.20
2	TW8380USB 闪存盘控制芯片	BS.185561918	自主取得	2018.08.28

3	TW9080	BS.195592123	自主取得	2019.05.17
4	TW2980	BS.195611276	自主取得	2019.09.25
5	TW2981	BS.205548555	自主取得	2020.07.06
6	TW8381	BS.215546792	自主取得	2021.04.27

#### 5、公司获取的主要技术许可情况

为保证存储卡产品在不同主机和设备之间的互操作性，SD-3C LLC 公司及其股东主导制定了 SD 存储卡的技术标准、规范，SD-3C LLC 公司拥有存储卡技术标准、规范相关的必要知识产权（包括专利、商标等），任何厂商生产、销售 SD 存储卡均不可避免地使用到 SD-3C LLC 公司所拥有的存储卡标准必要知识产权。SD 卡标准技术为存储卡行业内的开放技术，根据其技术垄断特点及各国反垄断相关要求，SD-3C LLC 公司对外公平开放存储卡标准必要知识产权的授权，行业每一进入者均可申请及获取该标准必要知识产权授权。我国国家工商总局《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》亦规定，经营者不得在行使知识产权的过程中，利用标准的制定和实施从事排除、限制竞争的行为，需遵守公平、合理和无歧视原则实施授权许可。

发行人的主要产品为存储卡模组，因发行人销售的模组产品未标注 SD 注册商标，发行人无需使用 SD-3C 公司的注册商标专用权，同时鉴于 SD-3C 公司的外观设计专利均已到期终止，发行人亦不涉及使用 SD-3C 公司外观设计专利的情形；但发行人存储卡模组需符合 SD 卡的其他相关技术要求，使用到 SD-3C LLC 公司关于 SD 存储卡的部分标准必要专利。2020 年 9 月，香港源德与 SD-3C LLC 公司签订了《SD MEMORY CARD LICENSE AGREEMENT》，发行人获取 SD 相关标志的使用授权，以及 SD 卡相关专利的授权许可。有效期间一年，届满后自动续展一年，至十年为止。根据（美国）LAW OFFICES OF BIN LI & ASSOCIATES 出具的法律意见，《SD MEMORY CARD LICENSE AGREEMENT》根据美国加州法律合法有效。

2020 年 8 月，香港源德与 SD-3C LLC 公司签订了《SETTLEMENT AGREEMENT》，就香港源德及其母公司于 2020 年 8 月 28 日之前涉及使用存储卡标准必要专利的情形，香港源德向 SD-3C LLC 公司一次性支付补偿款予以解决。根据（美国）LAW OFFICES OF BIN LI & ASSOCIATES 出具的法律意见，《SETTLEMENT AGREEMENT》根据美国加州法律合法有效。香港源德已按照

上述协议约定向 SD-3C LLC 公司支付相关补偿款。

发行人针对制造销售的存储卡产品的知识产权授权，已经与 SD-3C LLC 公司达成协议，获得了 SD-3C LLC 公司关于存储卡知识产权的充分授权，解决了历史问题和未来事项安排，已无来自 SD 卡协会、SD-3C LLC 公司方面的知识产权风险。

综上，发行人 2020 年 9 月前使用存储卡标准必要知识产权的事宜已获得 SD-3C LLC 公司追认确认，目前发行人不存在侵犯他人权利的情形，与 SD-3C LLC 公司不存在纠纷和法律风险。

## 六、同业竞争和关联交易情况

### （一）同业竞争

公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。

截至本招股说明书摘要签署之日，除发行人及其员工持股平台外，公司控股股东李虎及公司实际控制人李虎、田华夫妇未投资其他企业，不存在所控制的其他企业存在与公司从事相同或相似业务的情形。

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东李虎、实际控制人李虎、田华夫妇已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，对下列事项作出承诺和保证：

“1、在本承诺函签署之日，本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与德明利及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与德明利及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与德明利及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与德明利及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺函签署之日起，若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围，

本人及本人控制的企业将不与德明利及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与德明利及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到德明利经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、在本人及本人控制的企业与德明利存在关联关系期间以及关联关系消除之后的十二个月内，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向德明利赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

## （二）关联交易情况

### 1、经常性关联交易

报告期内，公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员薪酬	543.18	479.85	345.43

### 2、偶发性关联交易

#### 1) 关联担保情况

##### ①关联方为公司借款担保

报告期内，关联方为公司提供担保的具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	合同编号	担保主债权金额（万元）	主债权期间	是否履行完毕
1	李虎	德明利	755XY201800045601	800	2018.1.19-2019.1.18	是
	田华		755XY201800045602			
	魏宏章		755XY201800045603			
	白春华		755XY201800045604			
2	李虎、田华、魏宏章、白春华	德明利	SHZZX1610120180062-11	350	2018.04.17-2019.04.17	是
	李虎、田华、魏宏		深担（2018）年反担字（0802）号			

	章、白春华					
3	李虎、田华、魏宏章	德明利	(2018)深银短贷字第 000021 号-担保 01	500	2018.09.20-2019.09.20	是
	李虎、田华、魏宏章、白春华		深担(2018)年反担字(2185)号			
4	李虎、田华	德明利	005202018K00145	500	2018.10.19-2021.10.19	是
5	李虎、田华、魏宏章、白春华	德明利	保证 A201801727	400	2018.11.05-2019.11.04	是
6	李虎、田华	德明利	709915201900082-01	300	2019.01.21-2020.01.20	是
	魏宏章、白春华		709915201900082-02			
	何新宁、张翠兰		709915201900082-03			
7	李虎、田华、魏宏章、白春华	德明利	YB7926201928004302	2,000	2019.03.27-2020.03.27	是
	李虎、田华、魏宏章、白春华		深担(2019)年反担字(0563)号			
8	李虎、田华、魏宏章	德明利	(2019)深银短贷字第 000011 号-担保 01	500	2019.07.03-2020.07.03	是
	李虎、田华、魏宏章、白春华		保证 A201901052			
9	李虎、田华、魏宏章、白春华	德明利	深担(2020)年委贷保字(0639)号	1,000	2020.03.27-2021.03.26	是
10	李虎	德明	2020SC0000037421	4,000	2020.04.03-2023.04.02	是
	田华		2020SC0000037422			

		利				
11	李虎、田华、魏宏章、白春华	德明利	个保 A202000996	1,000	2020.04.16-2021.04.15	是
12	李虎、田华	德明利	2020 圳中银华普保字第 000089A 号	1,000	2020.04.28-2021.04.27	是
	魏宏章	利	2020 圳中银华普保字第 000089B 号			
13	李虎、田华、魏宏章、白春华	德明利	深担（2020）年反担字（1430-1）号	1,500	2020.04.23-2021.04.23	是
14	李虎、田华	德明利	交银深 2020 分营德明利保字 01 号	4,000	2020.04.23-2021.04.23	是
15	李虎	德明利	755XY202001486701	800	2020.06.02-2021.06.01	是
	田华		755XY202001486702			
	魏宏章		755XY202001486703			
16	田华	德明利	华兴江分额保字第 2020060217373001 号	6,000	2020.06.11-2023.06.01	否
	李虎		华兴江分额保字第 2020060217373002 号			
17	李虎、田华	德明利	2020 深银横最保字第 0011 号	5,000	2020.06.12-2022.06.01	是
18	李虎、田华、魏宏章	德明利	兴银深中保证字（2020）第 303-5 号、303-6 号、303-7 号	500	2020.7.15-2021.7.14	是
	李虎、田华、魏宏章、白春华		深兴担（2020）年反担字（0018-1）号、（0018-2）号			
19	李虎	德明利	兴银深中授信（保证）字（2020）第 303-1 号	360	2020.7.16-2021.5.11	是
	田华		兴银深中授信（保证）字（2020）第 303-2 号			
	魏宏章		兴银深中授信（保证）字（2020）第 303-3 号			
20	李虎、田华	德明利	个保 A202002368	500	2020.07.28-2021.07.27	是
21	李虎、田	德	81100520200000862	4,000	2020.8.24-	是



	华、魏宏章	明利			2021.8.20	
22	李虎、田华	德明利	2020 圳中银华普保字第 000220A 号	1,800	2020.10.22-2022.4.22	否
	魏宏章	利	2020 圳中银华普保字第 000220B 号			
23	李虎	德明利	平银企客一额保字 20201103 第 001 号	6,000	2020.11.3-2021.11.2	是
	田华		平银企客一额保字 20201103 第 002 号			
24	李虎、田华、魏宏章	德明利	深中小贷（2020）年借担字（0153）号	2,000	2020.11.23-2021.11.23	是
25	李虎	德明利	07300KB20A717AJ	5,000	2020.11.30-2021.11.30	是
	田华		07300KB20A71BHM			
26	李虎	德明利	HTC442008040ZGDB202100024	6,000	2021.03.10-2022.02.10	否
27	田华		HTC442008040ZGDB202100025			
28	魏宏章		HTC442008040ZGDB202100026			
29	白春华		HTC442008040ZGDB202100027			
30	田华	德明利	KCDDDB20210430022632	800	2021.04.30-2022.04.28	否
31	李虎、田华	德明利	2021 圳中银华普保字第 000156A 号	1,000	2021.05.11-2021.10.14	否
32	魏宏章		2021 圳中银华普保字第 000156B 号			
33	李虎、田华	德明利	交银深 2021 分营德明利保字 01 号	1,000	2021.05.12-2022.05.10	否
34	李虎、田华		交银深 2021 分营德明利保字 03 号	5,000		否
35	李虎、田华、魏宏章		深担（2021）年反担字（1941-1）号	1,000		否
36	李虎	德明利	兴银深中保证字（2021）第 810-1 号	1,500	2021.05.25-2022.05.25	否
37	田华		兴银深中保证字（2021）第 810-2 号			否
38	李虎、田华		个保 A202102296-01			否
39	李虎	德明利	GB39182107003-1《最高额保证合同》	10,000	2021.07.09-2022.07.08	否
40	田华		GB39182107003-2《最高额保证合同》			
41	李虎	德明	工银深自保布字 2021 年第 036 号	5,000	2021.08.05-2022.09.17	否
42	田华		工银深自保布字 2021 年第 037 号			

		利				
43	李虎、田华	德明利	(20925000) 浙商银高保字 (2021) 第 00009 号	6,600	2021.09.01-2022.09.01	否
44	李虎、田华	德明利	BZ161021002038	5,000	2021.09.27-2022.04.25	否
45	深圳市德明利光电有限公司		BZ161021002037			
46	李虎	德明利	公高保字第科苑 2100401 号	8,000	2021.10.15-2022.10.15	否
47	田华		公高保字第科苑 2100402 号			
48	源德(香港)有限公司		公高保字第科苑 2100403 号			
49	李虎	德明利	平银企客一额保字 20211112 第 002 号	6,000	2021.11.12-2022.11.11	否
50	田华		平银企客一额保字 20211112 第 001 号			

注：何新宁与张翠兰系夫妻关系，魏宏章与白春华系夫妻关系。

## ②关联方为公司其他业务提供担保

报告期内，关联方为公司其他业务提供担保的具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方式	担保范围	签订日期	担保是否已经履行完毕
1	李虎、魏宏章	德明利	连带保证	《供应链服务协议》(SJET-2017-134) 及项下补充协议全部债权	2017.4.21	是
2	李虎、田华	德明利	连带保证	《代理采购协议》(SJET-2017-408) 及项下补充协议全部债权	2017.10.10	是
3	李虎、田华	德明利	连带保证	《外贸综合服务协议》(SJET-2018-758) 及项下补充协议全部债权	2018.12.29	是
4	李虎、田华	德明利	连带保证	《委托代理进口协议》(20190300459)、《外贸综合服务协议》(20190200370)、《香港本地交货协议》(2019030055) 及项下补充协议全部债权	2019.5.7	否
5	李虎、田华	德明利	连带保证	《代理采购协议》(SJET-2019-271) 及项下补充协议全部债权	2019.10.10	是

6	李虎、田华	德明利	连带保证	《外贸综合服务协议》(SJET-2020-486)及项下补充协议全部债权	2020.12.29	否
7	李虎	德明利	连带保证	《代理进口服务协议》(XYHTSP2105270002)、《代理出口服务协议》(XYHTSP2106220003)	2021.6.23	否
8	田华	德明利	连带保证	《代理进口服务协议》(XYHTSP2105270002)、《代理出口服务协议》(XYHTSP2106220003)	2021.6.23	否

上述关联方无偿为公司融资或业务提供相关担保，未向公司收取任何费用，上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，并在一定程度上保证了公司生产经营的正常开展，使公司能够及时获得业务发展所需补充的资金，从而为公司经营业绩提供了有益的支持。

## 2) 关联方资金拆借

报告期内，公司与关联方资金拆借情况如下：

### ①李虎、田华

报告期内，公司与李虎、田华存在往来款项，具体情况如下：

单位：万元

期间	期初应付往来款余额	本期增加金额	本期减少金额	期末应付往来款余额
2019年	-	55.00	55.00	-
2020年	-	30.00	30.00	-
2021年	-	-	-	-

报告期内，公司与实际控制人的上述资金往来均为公司因临时资金周转需要，暂时性借入资金，并相应归还相关借款所致。

### ②魏宏章

报告期内，公司与魏宏章存在往来款项，具体情况如下：

单位：万元

期间	期初应付往来款余额	本期增加金额	本期减少金额	期末应付往来款余额
2019年	445.00	1,080.00	1,525.00	-
2020年	-	-	-	-
2021年	-	-	-	-

报告期内，公司与魏宏章的往来款项为公司因资金周转需要，临时性向魏宏章借入资金，并相应归还相关借款所致，相关款项已于 2019 年结清，后续未再发生。

③贺伟

贺伟系公司股东徐岱群之配偶，报告期内，公司与贺伟存在往来款项，具体情况如下：

单位：万元

期间	期初应付往来款 余额	本期增加金额	本期减少金额	期末应付往来款 余额
2019 年	-	400.00	400.00	-
2020 年	-	-	-	-
2021 年	-	-	-	-

2019 年，公司与贺伟的往来款项为公司因资金周转需要，临时性向贺伟借入资金，并相应归还相关借款所致，相关款项已于 2019 年结清，后续未再发生。

报告期内，因公司经营规模扩张较快，短期运营资金周转需求较大，导致形成向股东方进行临时性资金拆借，2019 年股权融资资金到位后，公司运营资金较为充足，归还相关拆入资金，报告期末，相关款项已结清。

④深圳市源德来投资有限公司

深圳市源德来投资有限公司系公司实际控制人田华曾控制的企业，报告期内，公司与深圳市源德来投资有限公司存在往来款项，具体情况如下：

单位：万元

期间	期初应付往来款 余额	本期增加金额	本期减少金额	期末应付往来款 余额
2019 年	299.00	-	-	299.00
2020 年	299.00	-	299.00	-
2021 年	-	-	-	-

2015 年，深圳市源德来投资有限公司拟出资认购德名利有限部分股权，并于 2015 年 5 月将投资款项 299.00 万元转至德名利有限银行账户，后由于深圳市源德来投资有限公司当时的股东田华、魏宏章、徐岱群和谢红鹰等经商议后改变投资方案，决定不再以深圳市源德来投资有限公司为主体认购德名利有限股权，而是由魏宏章、徐岱群和谢红鹰等直接出资入股德名利有限，但由于公司发展较快，资金运转需求较高，公司股东为支持公司发展，一直未要求收回该款项。截

至 2020 年末，公司已归还深圳市源德来投资有限公司该款项，相关款项已结清。

### 3、关联交易汇总表

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
关键管理人员薪酬	543.18	479.85	345.43
代收货款	-	-	-
代付采购款	-	-	-
代付其他	-	-	-
关联资金拆借	-	30.00	1,535.00
关联担保（公司作为被担保方）	关联方为发行人借款提供担保	关联方为发行人借款提供担保	关联方为发行人借款提供担保
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收关联方余额	-	-	-
应付关联方余额	-	-	455.06

### 4、关联交易对公司报告期财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的经常性关联交易及偶发性关联交易对本公司的财务状况和经营成果无重大影响，符合业务发生时的《公司章程》以及相关协议规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在通过关联交易输送利益或调节利润的情形。

### （三）发行人关联交易制度履行情况及独立董事意见

公司报告期内发生的关联交易均履行了《公司章程》规定的审批程序，公司独立董事均已对公司报告期内的关联交易进行认真审核并发表如下独立意见：公司已在《公司章程》等制度中制定了减少和规范关联交易的措施、关联交易表决程序及关联方回避制度，公司有效地执行了上述制度的规定。公司最近三年与关联方发生关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，提高生产经营保障程度，关联交易履行了必要的法定批准程序，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况见下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2021 年薪酬情	直接或间接持有公司股
----	----	----	----	--------	------	------	-----------	------------

							况(万元)	份数量(股)
李虎	董事长、常务副总经理	男	46	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市晶海利电子科技有限公司市场总监等；历任德名利有限总经理、执行董事、董事；	无	87.10	32,088,887
田华	董事、总经理、董事会秘书	女	42	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市思源计算机软件有限公司客服总监、市场总监、副总经理等；历任德名利有限总经理、执行董事、董事长	无	62.40	348,529
CHEN LEE HUA	董事、副总经理	男	54	2020年3月-2023年3月	曾任 Skylight Entertainment 市场部经理、Regent International 总经理、Rapid Access International Limited 区域董事、GREAT UNION TECHNOLOGY 首席执行官、Innovation Asia Group Limited 行政部顾问、德名利有限存储事业部负责人等。	无	67.56	163,596
孙铁军	董事、技术总监	男	63	2020年3月-2023年3月	曾任长春工业大学(原吉林工学院)自动化教研室讲师、吉林省电子技术研究所开发部总工、深圳市捷顺科技实业股份有限公司开发部经理、深圳卡普智能有限公司开发部总工程师、深圳市天毅科技有限公司技术总监、德名利有限技术总监等。	无	43.36	53,585
张汝京	独立董事	男	73	2020年3月-2023年3月	曾任世大半导体总裁、中芯国际总经理、映瑞光电科技(上海)有限公司董事长、昇瑞光电科技(上海)有限公司总经理、上海新昇半导体科技有限公司总裁、董事、芯恩(青岛)集成电路有限公司董事长等。	上海皓芯投资管理有限公司董事长、宁波芯恩半导体科技有限公司董事长兼经理、芯恩(青岛)集成电路有限公司董事长、圣泰集团有限公司董事、嘉万国际有限公司董事、有研半导体硅材料股份有限公司独立董事	24.00	-
周建国	独立董事	男	66	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市商贸投资控股公司审计部长、财务部长、总裁助理，深圳市投资控股有限公司财务部长、副总经理，深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司党委书记、董事长等。	深圳易科声光科技股份有限公司独立董事	24.00	-
曾献君	独立董事	男	55	2020年3月-2023年3月	曾任国防科学技术大学计算机学院讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师；2009年3月至今，历任中兴通讯股份有限公司微电子研究院技术专家、高级技术专家、技术顾问、首席技术专家。	中兴通讯股份有限公司顶级技术专家	24.00	-

叶柏林	副总经理	男	46	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市同洲电子科技股份有限公司研发工程师、深圳市朗科科技股份有限公司研发副总监、深圳市杰成电子有限公司研发总监、深圳市杰成电子有限公司研发总监、钉钉拍（深圳）技术股份有限公司产品总监、德名利有限光电事业部负责人等。	无	62.13	160,756
何新宁	财务负责人	男	53	2020年3月-2023年3月	曾任广东皇威集团有限公司财务经理、深圳康美投资有限公司财务总监，深圳康美生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书等，德名利有限财务负责人等。	深圳市康美投资有限公司监事	46.15	357,236
李国强	监事会主席、芯片总工程师、芯片研发部经理	男	37	2020年3月-2023年3月	曾任基通仓储国际贸易（深圳）有限公司技术部固件工程师、深圳芯邦科技股份有限公司研发部高级固件工程师、蓝略科技（香港）有限公司研发部资深固件工程师、深圳市硅格半导体有限公司研发部资深芯片工程师、项目经理、德名利有限芯片总工程师、芯片研发部经理等。	无	61.37	312,581
李鹏	监事、现场技术支持工程师	男	35	2020年3月-2023年3月	曾任信利光电股份有限公司研发部开发工程师、深圳市鑫锐茂贸易有限公司技术部技术研发负责人，历任德名利有限现场技术支持工程师兼硬件工程师、现场技术支持工程师经理。	无	21.10	107,171
何勇	监事、现场技术支持工程师	男	35	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市丽美科技有限公司工程部生产工程师、德名利有限现场技术支持工程师等。	无	20.01	107,171

注：1、以上薪酬均为税前金额。

除上述情况外，公司董事、监事和高级管理人员与公司不存在其他利益关系。

## 八、发行人控股股东及实际控制人简介

截至本招股说明书摘要签署之日，公司总股本为 6,000.00 万股，李虎直接持有公司 3,208.8887 万股股份，占公司总股本的 53.4816%，系公司控股股东。李虎现任公司董事长，田华担任公司总经理，李虎和田华系夫妻关系，李虎直接控制公司的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，李虎和田华夫妇为发行人实际控制人。李虎和田华夫妇的基本情况如下：

**李虎**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，身份证号码为 43062219750917\*\*\*\*，本科学历。2000 年 4 月至 2008 年 9 月，任深圳市晶海利

电子科技开发有限公司市场总监；2008年11月创办德名利有限，至2020年2月历任德名利有限总经理、执行董事、董事；2020年3月至今，任德名利董事长、常务副总经理。

田华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，身份证号码为22010319791021\*\*\*\*，浙江大学工商管理学硕士在读。2004年3月至2011年9月，历任深圳市思源计算机软件有限公司客服总监、市场总监、副总经理；2011年9月至2020年2月，历任德名利有限总经理、执行董事、董事长；2020年3月至今，任德名利董事、总经理、董事会秘书。田华女士无其他兼职情况。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

## 九、简要财务会计信息

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	117,625,279.29	72,011,077.10	33,624,755.68
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	146,785,277.12	121,786,826.24	99,138,861.69
应收款项融资	-	-	-
预付款项	75,865,794.19	53,283,305.22	44,899,118.82
其他应收款	10,144,697.73	4,654,915.48	16,318,454.41
存货	565,548,306.51	437,423,040.86	287,442,921.91
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	57,434,195.89	37,539,933.12	18,051,903.71
<b>流动资产合计</b>	<b>973,403,550.73</b>	<b>726,699,098.02</b>	<b>499,476,016.22</b>



<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	28,000,396.45	16,966,878.22	5,845,957.92
在建工程	79,769,625.83	9,096,745.00	1,543,296.36
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	32,595,052.55	-	-
无形资产	-	7,766.94	28,571.76
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	16,642,152.66	17,554,793.27	6,857,348.11
递延所得税资产	8,546,201.84	4,162,170.35	2,452,685.05
其他非流动资产	6,989,027.73	44,644,964.40	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>172,542,457.06</b>	<b>92,433,318.18</b>	<b>16,727,859.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,145,946,007.79</b>	<b>819,132,416.20</b>	<b>516,203,875.42</b>
<b>负债与所有者权益</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	262,128,616.39	166,680,000.00	23,450,000.00
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	97,140,000.00	-	-
应付账款	78,952,071.25	82,753,653.06	86,252,403.27
预收款项	-	-	4,527,973.85

合同负债	21,804,080.61	15,107,388.71	-
应付职工薪酬	8,655,134.88	4,930,380.82	3,251,748.75
应交税费	17,519,262.85	15,940,713.77	12,109,533.38
其他应付款	15,992,764.90	29,869,974.06	37,244,177.94
其中：应付利息	303,701.65	745,599.85	62,483.61
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	21,879,990.54	6,060,000.00	1,243,741.31
其他流动负债	131.15	1,673,135.04	-
<b>流动负债合计</b>	<b>524,072,052.57</b>	<b>323,015,245.46</b>	<b>168,079,578.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	13,500,000.00	2,280,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	28,472,241.45	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	39,678,700.00	34,200,500.00	750,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>68,150,941.45</b>	<b>47,700,500.00</b>	<b>3,030,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>592,222,994.02</b>	<b>370,715,745.46</b>	<b>171,109,578.50</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	22,394,168.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	295,562,594.59	286,123,662.77	243,132,364.63
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-6,122,375.84	-4,089,926.58	-244,532.14

专项储备	-	-	-
盈余公积	18,531,851.87	8,792,613.83	7,446,460.42
未分配利润	185,750,943.15	97,590,320.72	72,365,836.01
归属于母公司股东权益合计	553,723,013.77	448,416,670.74	345,094,296.92
少数股东权益	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>553,723,013.77</b>	<b>448,416,670.74</b>	<b>345,094,296.92</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,145,946,007.79</b>	<b>819,132,416.20</b>	<b>516,203,875.42</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,079,781,478.82</b>	<b>834,708,606.82</b>	<b>645,645,294.82</b>
减：营业成本	860,693,926.89	645,543,076.64	518,492,680.00
税金及附加	1,960,301.46	1,594,435.59	947,758.83
销售费用	4,672,875.13	11,861,187.87	4,691,208.62
管理费用	30,601,774.39	30,542,825.77	30,897,485.05
研发费用	45,780,184.88	38,919,384.12	37,073,155.28
财务费用	17,762,592.93	19,267,680.51	4,557,878.80
其中：利息费用	16,347,026.66	9,564,831.41	6,682,709.08
利息收入	29,597.25	16,688.49	6,693.13
加：其他收益	2,094,412.05	1,823,566.22	558,323.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,104,559.56	566,637.53	-1,394,304.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,011,340.99	-19,082,216.62	-1,035,534.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	-

号填列)			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>105,288,334.64</b>	<b>70,288,003.45</b>	<b>47,113,613.15</b>
加：营业外收入	5,004,000.00	22,000,000.00	600,000.00
减：营业外支出	220,000.00	4,600.00	267,443.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>110,072,334.64</b>	<b>92,283,403.45</b>	<b>47,446,169.45</b>
减：所得税费用	11,903,439.03	15,161,600.50	10,737,936.87
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>98,168,895.61</b>	<b>77,121,802.95</b>	<b>36,708,232.58</b>
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,168,895.61	77,121,802.95	36,708,232.58
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	98,168,895.61	77,121,802.95	36,708,232.58
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-2,032,449.26</b>	<b>-3,845,394.44</b>	<b>-746,491.51</b>
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-2,032,449.26	-3,845,394.44	-746,491.51
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	-2,032,449.26	-3,845,394.44	-746,491.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-

(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(7) 现金流量套期储备	-	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-2,032,449.26	-3,845,394.44	-746,491.51
(9) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>96,136,446.35</b>	<b>73,276,408.51</b>	<b>35,961,741.07</b>
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	-	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>七、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益	1.64	1.29	0.61
(二) 稀释每股收益	1.62	1.28	0.61

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,156,161,822.72	921,612,486.01	625,388,220.12
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,798,534.05	58,549,325.15	12,763,984.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,169,960,356.77</b>	<b>980,161,811.16</b>	<b>638,152,204.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,608,757.32	895,894,483.37	737,789,241.53
支付给职工以及为职工支付的现金	45,505,611.18	27,495,525.18	16,806,971.84
支付的各项税费	26,501,883.99	26,737,916.71	12,703,817.86
支付其他与经营活动有关的现金	24,719,799.95	43,300,735.31	13,643,691.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,159,336,052.44</b>	<b>993,428,660.57</b>	<b>780,943,722.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,624,304.33</b>	<b>-13,266,849.41</b>	<b>-142,791,517.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
<b>投资活动现金流入小计</b>			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,147,506.09	80,091,412.73	5,594,093.93
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>57,147,506.09</b>	<b>80,091,412.73</b>	<b>5,594,093.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-57,147,506.09</b>	<b>-80,091,412.73</b>	<b>-5,594,093.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			172,240,446.80
取得借款收到的现金	303,139,672.26	201,000,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,046,747.37	68,407,535.17
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>303,139,672.26</b>	<b>204,046,747.37</b>	<b>274,647,981.97</b>
偿还债务支付的现金	182,420,000.00	41,570,000.00	25,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,523,489.53	9,658,017.70	1,973,548.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金	35,793,790.68	21,928,452.71	66,841,563.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>236,737,280.21</b>	<b>73,156,470.41</b>	<b>94,745,111.51</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,402,392.05</b>	<b>130,890,276.96</b>	<b>179,902,870.46</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,893,755.58</b>	<b>854,306.60</b>	<b>-104,467.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>17,985,434.71</b>	<b>38,386,321.42</b>	<b>31,412,790.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	72,011,077.10	33,624,755.68	2,211,964.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>89,996,511.81</b>	<b>72,011,077.10</b>	<b>33,624,755.68</b>

(二) 非经常性损益

依据经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表, 本公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额以及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表:

单位: 万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	709.84	2,445.49	115.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22.00	-0.46	-26.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-2,449.01	-3,683.74
减: 所得税影响额	104.89	366.75	13.36
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	582.95	-370.74	-3,608.01
归属于母公司股东的净利润	9,816.89	7,712.18	3,670.82
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	9,233.94	8,082.92	7,278.84

### (三) 主要财务指标

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	1.86	2.25	2.97
速动比率(倍)	0.78	0.90	1.26
资产负债率(母公司)	50.71%	40.35%	31.33%
资产负债率(合并)	51.68%	45.26%	33.15%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.00%	0.00%	0.01%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	9.23	7.47	15.41
财务指标	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率(次)	7.93	7.45	8.28
存货周转率(次)	1.69	1.76	2.24
息税折旧摊销前利润(万元)	14,322.48	10,646.70	5,681.68
归属于发行人股东的净利润(万元)	9,816.89	7,712.18	3,670.82
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	9,233.94	8,082.92	7,278.84
利息保障倍数	7.73	10.65	8.10

每股经营活动产生的现金流量（元）	0.18	-0.22	-6.38
每股净现金流量（元）	0.30	0.64	1.40

#### （四）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，本公司报告期内的净资产收益率及每股收益如下：

单位：元

会计期间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本	稀释
2021年度	归属于母公司股东的净利润	19.73%	1.64	1.62
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	18.56%	1.54	1.52
2020年度	归属于母公司股东的净利润	20.10%	1.29	1.28
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	21.07%	1.35	1.34
2019年度	归属于母公司股东的净利润	20.32%	0.61	0.61
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	40.30%	1.21	1.21

## 十、管理层讨论与分析

### （一）资产负债分析

#### 1、资产结构分析

报告期内，随着公司业务快速发展及股权、债权融资的有序推进，公司资产规模整体呈增长态势。报告期各期末，公司的总资产分别为51,620.39万元、81,913.24万元和114,594.60万元。公司的资产结构及其变化情况如下：

单位：万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	97,340.36	84.94%	72,669.91	88.72%	49,947.60	96.76%
非流动资产	17,254.25	15.06%	9,243.33	11.28%	1,672.79	3.24%
<b>合计</b>	<b>114,594.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>81,913.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,620.39</b>	<b>100.00%</b>

2019年末、2020年末和2021年末，公司流动资产占总资产的比重分别为96.76%、88.72%和84.94%，非流动资产占总资产的比重分别为3.24%、11.28%



和 15.06%。

## 2、负债结构分析

报告期内，公司的负债主要以流动负债为主，具体构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	52,407.21	88.49%	32,301.52	87.13%	16,807.96	98.23%
非流动负债	6,815.09	11.51%	4,770.05	12.87%	303.00	1.77%
合计	<b>59,222.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,071.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,110.96</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 现金流量与偿债能力分析

### 1、经营活动现金流基本情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	115,616.18	92,161.25	62,538.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,379.85	5,854.93	1,276.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>116,996.04</b>	<b>98,016.18</b>	<b>63,815.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	106,260.88	89,589.45	73,778.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,550.56	2,749.55	1,680.70
支付的各项税费	2,650.19	2,673.79	1,270.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,471.98	4,330.07	1,364.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>115,933.61</b>	<b>99,342.87</b>	<b>78,094.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,062.43</b>	<b>-1,326.68</b>	<b>-14,279.15</b>

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-14,279.15 万元、-1,326.68 万元和 1,062.43 万元，2019 年和 2020 年经营活动产生的现金流量净额均为负，2021 年发行人经营活动现金流净额转正。存储行业系资金密集型行业，公司为保持技术先进性、增强市场竞争力，持续进行研发投入和规模扩张，经营活动现金投入较大。具体来说：

报告期内，公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为 96.86%、110.41%和 107.07%，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例较高，销售收款情况良好。

报告期内，公司经营活动现金流出分别为 78,094.37 万元、99,342.87 万元和 115,933.61 万元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金，金额较大，主要系随着公司的研发技术积累日益成熟，发行人的存储管理应用方案体现了较强的竞争优势，公司盈利能力的增强使得公司经营安全边际日益提升，业绩预期日益增强，公司的融资能力得到有效提升。报告期内，公司通过加强债权融资及股权融资规模获得较多筹资性资金流入，公司在对未来存储行业市场长期乐观预期的基础上，为了进一步通过“以技术带动盈利，以资金驱动规模”实现业务扩张，根据市场情况战略性的增加了存货储备规模，同时，在报告期内营运资金相对充裕的基础上，公司进一步扩张产品线、加强研发投入和人员引进。

## 2、偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债能力指标如下：

财务指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产负债率（母公司）（%）	50.71	40.35	31.33
资产负债率（合并）（%）	51.68	45.26	33.15
流动比率（倍）	1.86	2.25	2.97
速动比率（倍）	0.78	0.90	1.26
财务指标	2021年度	2020年度	2019年度
息税折旧摊销前利润（万元）	14,322.48	10,646.70	5,681.68
利息保障倍数（倍）	7.73	10.65	8.10
经营活动现金净流量（万元）	1,062.43	-1,326.68	-14,279.15

报告期内，公司具备较好的偿债能力，不存在债务风险。

## （三）营业收入分析

报告期内，公司的营业收入构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	107,978.15	100.00%	83,470.86	100.00%	64,564.53	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>107,978.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>83,470.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,564.53</b>	<b>100.00%</b>

公司主要从事闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售，公司营业收入主要来自于存储模组产品销售及部

分存储晶圆销售等，存储业务收入占比超过 99%。报告期各期，公司主营业务收入分别为 64,564.53 万元、83,470.86 万元和 107,978.15 万元，占营业收入的比重均为 100.00%，公司无其他业务收入。

其中，2020 年发行人营业收入较 2019 年增加 18,906.33 万元，增加 29.28%，2021 年较 2020 年增加 24,507.29 万元，增加 29.36%。报告期内，公司营业收入呈现逐年增长态势，盈利能力不断增强。

#### （四）利润来源

报告期内，公司的利润情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	107,978.15	83,470.86	64,564.53
营业利润	10,528.83	7,028.80	4,711.36
利润总额	11,007.23	9,228.34	4,744.62
营业利润占利润总额比例	95.65%	76.17%	99.30%
净利润	9,816.89	7,712.18	3,670.82

报告期内，公司营业利润占利润总额的比例分别为 99.30%、76.17% 和 95.65%，公司利润主要来源为营业利润，营业利润主要来源于主营业务。其中，2020 年公司营业利润与利润总额差异较大主要系公司营业外收入较大所致。

#### （五）当前财务和盈利状况以及未来趋势分析

##### 1、当前经营情况

报告期内，公司致力于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的优化，以及存储模组产品的销售。公司高度重视自主创新，研发团队通过多年的技术积累和研发储备，陆续研发推出了多款高性能闪存主控芯片，极大提高了公司对海力士（SK Hynix）、英特尔（Intel）、三星电子（SAMSUNG）等存储原厂多种型号存储晶圆的管理利用效率，增强了移动存储产品的成本优势和市场竞争力。同时，公司按照长期战略发展要求，积极开展触控芯片的研发，目前已初步形成自研触摸控制芯片投片、触控模组优化等一体化解决方案，为客户提供 6.5 寸至 21.5 寸的小、中、大多尺寸显示屏的触控芯片产品，并实现小批量试产出货，并逐步导入智能家电领域、后装车机领域和中大屏商显领域等市场；公司于 2020 年 6 月成立全资子公司德明利光电并组建光通讯产品研发团队，以

VCSEL 光芯片的设计、研发及产业化应用为运营方向，旨在满足智能终端、无人驾驶汽车等新一代信息技术产品快速增长的产业化应用需求，目前处于产业化应用探索阶段。

公司在存储卡、存储盘和固态硬盘等存储产品的供产销领域积累了丰富的技术成果、行业资源以及经营经验，逐步形成了“前端资源整合、主控芯片研发、存储模组供应、行业市场开发”等全链条的存储模组设计与运营公司，公司与存储原厂、境内外封装测试外协厂商、移动存储产品渠道分销商及品牌商等建立了稳定、信任的合作关系，通过与行业生态内的企业协同、分工、合作，公司深度优化整合行业生态系统内的市场资源和技术资源。

报告期内，公司经营规模呈扩大趋势。报告期内，公司实现的营业收入分别为 64,564.53 万元、83,470.86 万元和 107,978.15 万元，扣除非经常性损益后实现的净利润分别为 7,278.84 万元、8,082.92 万元和 9,233.94 万元，显示出良好的发展势头和盈利能力。

## 2、未来趋势分析

集成电路行业作为全球信息产业的基础，经历了 60 多年的发展，如今已成为世界信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中不可少的组成部分。根据中国海关统计数据，截至 2020 年中国集成电路进口规模已经连续数年超过原油，成为中国进口规模最大的产品品类。其中，存储器进口金额占集成电路进口总额的比例超过 30%，存储器芯片严重的进口依赖已成为直接影响国家产业安全和信息安全的重要问题。存储行业是全球集成电路市场比重最大的应用领域之一，根据全球半导体贸易统计组织数据，2018 年至 2020 年，存储器芯片占全球集成电路销售额的比例在 35%左右，存储器芯片是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。中国拥有全球最大的电子产品生产及消费市场，对存储器等集成电路产品产生了巨大的需求，未来，随着物联网、人工智能、大数据等新兴领域的不断涌现，以及相关国家战略的陆续实施，将直接带动存储器市场的巨大需求，市场空间广阔。

报告期内，公司未出现对公司持续经营能力产生重大不利影响的因素，根据所处行业发展趋势以及公司技术积累和业务发展状况，公司具备良好的成长性。

## （六）近三年分配情况、发行前滚存利润的分配政策及发行后股利分配政策

报告期内，发行人不存在股利分配的情况。经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司本次公开发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

## （七）发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

截至本招股说明书摘要签署之日，公司共拥有 2 家子公司，发行人子公司具体情况如下：

### 1、香港源德

公司名称	源德（香港）有限公司		
公司编号	2521769		
股本	19,847,482 港元		
董事	李虎、田华		
成立日期	2017 年 4 月 5 日		
注册地址	Flat/Rm 02,8/F,New Treasure Center,10 Ng Fong Street,San Po Kong		
生产经营地	Flat/Rm 02,8/F,New Treasure Center,10 Ng Fong Street,San Po Kong		
股东构成	德明利持股 100%		
经营范围	集成电路产品的设计、销售、进出口业务；其他货物进出口及技术进出口；对外投资，国际市场合作开发以及政府允许的其他业务。		
与发行人主营业务的关系	公司的境外业务平台		
主要财务数据 (经大信会计师审计，单位：万元)	2021 年度/2021 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	21,333.12	6,732.79	2,054.68

### 2、德明利光电

公司名称	深圳市德明利光电有限公司
成立时间	2020 年 6 月 11 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
法定代表人	叶柏林
注册地	深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号顺丰工业厂房 1 层 B125 房

主要生产经营地	深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号顺丰工业厂房 1 层 B125 房		
股东构成	德明利持股 100%		
经营范围	一般经营项目是：光电集成芯片、器件、模块、软件的研发、技术咨询、技术服务；光通讯收发模块的研发、设计、技术咨询、技术服务；光电器件、模块、光通讯收发模块、计算机软件的销售；从事货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：光电器件、模块、光通讯收发模块、计算机软件的生产。		
与发行人主营业务的关系	发行人的全资子公司，主要从事光电集成芯片、器件、模块、软件的研发及产业化。		
主要财务数据 (经大信会计师 审计,单位:万元)	2021 年度/2021 年 12 月 31 日		
	总资产	净资产	净利润
	11,041.85	2,425.97	-1,279.58

## 第四节募集资金运用

### 一、项目简表

公司本次发行募集资金投资项目按轻重缓急程度排序如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	建设期	项目是否备案
1	3DNAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目	29,941.88	16,196.89	36个月	深福田发改备案(2020)0227号
2	SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目	32,151.82	17,392.35	36个月	深福田发改备案(2020)0228号
3	深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目	46,619.93	2,000.00	24个月	深福田发改备案(2020)0229号
4	补充流动资金项目	45,000.00	10,000.00	36个月	--
合计		<b>153,713.63</b>	<b>45,589.24</b>	--	--

若本次发行及上市实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹予以解决。若本次发行及上市实际募集资金净额（扣除发行费用后）超出本次募集资金投资项目的资金需求，超过部分将依照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于其他与主营业务相关的营运资金。如本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际需要以其他资金（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后予以置换。

### 二、募集资金投资项目前景分析

#### （一）募集资金对未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目系基于公司发展规划要求制定，通过改善公司进行芯片研发所需软硬件设施，招聘并培养一支优秀的研发团队，有助于实现公司现有技术创新升级和产品迭代；在 3D NAND Flash 对上一代 NAND Flash 替代性越来越强的趋势下，进行 3D NAND Flash 移动存储主控芯片和 SSD 主控芯片等的研

发，可全面提升公司在存储模组领域的核心竞争力和市场占有率，保障公司持续发展，实现未来经营战略。具体来说：

本次募集资金投资项目中，“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”是在公司现有自研 3D NAND 移动存储主控芯片及移动存储模组解决方案基础上进行技术升级，研发 28nm 及以下工艺制程的高性能低功耗的闪存主控 SOC 芯片，推动移动存储模组产品技术迭代；“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”是在现有系列闪存主控芯片及产业化应用方案的基础上，通过设计高效的 CPU 子系统，优化数据流编解码 IP，完成 22nm 及以下工艺制程的 SSD 主控 SOC 芯片设计，推动 SSD 模组产品的技术迭代；研发中心建设项目将综合技术研发、集成电路布图设计、新品实验、功能测试等功能为一体，加强和巩固公司在闪存主控芯片技术上的创新、创造及存储模组产品领域的竞争力，并有效提升公司在人机交互等其他业务领域的自主创新能力和研发水平。

## （二）募集资金投资项目的可行性和必要性分析

### 1、可行性分析

#### （1）政策可行性

集成电路产业是国民经济支柱性行业之一，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程，因此受到各国政府的大力支持。近年来，我国政府十分重视集成电路行业的发展状况，并在税收、研究支持、人才培养等各方面颁布了多项产业政策及优惠政策，大力支持集成电路产业的发展。2015 年 5 月国务院颁布的《中国制造 2025》将集成电路作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平；2016 年 12 月国务院的颁布《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，要求国家发改委、工信部等按职责分工负责做强信息技术核心产业，组织实施集成电路发展工程，提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片；2018 年 3 月财政部等发布的《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》，将为部分集成电路生产企业减免所得税，旨在鼓励新建集成电路生产企业，优化产业结构，促进我国集成电路行业快速发展；2018 年 7 月工信部和国家发改委印发的《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020）》，进一步落实鼓励软件和



集成电路产业发展的若干政策，加大现有支持中小微企业税收政策落实力度；2019年3月，国务院颁布的《2019年国务院政府工作报告》，提出深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济；2020年7月，国务院颁布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。

本次募集资金投资项目属于集成电路设计产业，是目前国内重点发展的高新技术产业，符合国家产业政策，得到国家及地方政府的鼓励和支持。因此，本次募集资金投资项目具备政策可行性。

### （2）管理可行性

一个完整的芯片设计项目包括初期产品规划、中期设计实施、后期制造与封装测试和市场销售阶段，其中每个阶段又分若干步骤，比如中期设计实施又包括逻辑、版图、建库等多个设计步骤，每一个步骤都需要具体可操作的流程管理制度。公司成立于2008年，高管团队及业务团队核心成员基本拥有10年以上从业经验，从上端资源积累，中间研发技术积累，到市场下游客户积累都十分深厚，对行业有着极其深刻的理解，在研发及市场方面能找到快速有效的管理路径。公司在多个成功芯片设计项目的基础上，已建立了较为完善的研发流程和有效的管理制度，能够保障募集资金投资项目的推进效率和研发过程中的质量管控，提高投片成功率，降低流片及时间成本，保障预期的量产时间并产生经济效益。因此，本次募集资金投资项目具备管理可行性。

### （3）技术可行性

本次募集资金投资项目具有技术密集型特征，涉及高等数学、应用物理以及计算机、通信和信息等多学科、多专业的相互交叉、融合，芯片研发的技术难度较高。基于此，公司对本次募集资金投资项目所需技术创新进行了大量预研，同时在充分市场调研的基础上，对关键技术的市场适应性、先进性和收益性做出比较科学、全面的评估。

另外，在研发经验方面，公司通过多年的芯片研发实践，已形成一定的技术

积累，如基于 MLC、TLC 等架构的 3D NAND 移动存储主控芯片纠错算法，能够增强对数据的纠错能力，提高闪存数据存储密度容量和降低单位存储成本，为公司在 3D NAND 移动存储及 SSD 主控芯片的升级换代和技术创新奠定了技术基础。在研发团队建设方面，公司自成立以来，研发人员长期保持稳定，已培养出一个稳定、优秀的研发团队，覆盖研发设计过程的各环节，具备丰富的芯片研发经验，为公司芯片产品迭代和新产品技术创新奠定了坚实的基础。在技术风险控制方面，公司对于芯片创新性的关键技术，采用 FPGA 进行全面的仿真验证，并进行 MPW 流片进行功能验证，最大范围地有效控制和规避技术风险。因此，本次募集资金投资项目具备技术可行性。

#### （4）市场可行性

5G 时代的到来，新增大量的数据存储需求，随着云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的涌现，全球所产生的数据需求量呈现持续爆发式增长的趋势。根据 IDC 机构预测，到 2023 年全球数据总量将从 2018 年的 33ZB 增加到 103ZB，2025 年将进一步提高到 175ZB，年复合增长率将达到 61%。其中，2018 年全球所产生的数据量中有 5ZB 保存下来，预计到 2023 年所产生的 103ZB 数据量将有 12ZB 会被存储下来，存储应用市场的增长潜力巨大。

目前，我国存储市场规模巨大，但存储市场主流的主控芯片主要来源于台湾或美国厂商，境外集成电路设计企业在国内存储芯片市场占据了主要份额。本次募集资金投资项目的实施将有利于公司继续深入研发 3D NAND 主控芯片相关技术，顺应全球市场需求和闪存主控芯片国产化的大趋势。因此，本次募集资金投资项目具备市场可行性。

## 2、必要性分析

### （1）有助于提高国产芯片自给率

存储器一直都是中国集成电路市场份额占比最大的领域之一，据 CSIA 数据显示，2018 年我国存储器市场销售额为 5,575 亿元，同比增长 34.2%，占全球市场份额的 50% 以上，但主要依赖于国外进口。存储行业对我国国民经济的发展起着重要作用，关系着我国国家信息安全和普通民众的私人信息安全，是我国信息安全工作的重中之重，战略地位突出。闪存主控芯片是 CPU 与存储器之间数据交换的中介，决定了存储器最大容量、存取速度等多个重要性能参数以及信息安

全性。特别是在 AI、5G、LOT 时代，对于数据处理、存储速度以及信息安全要求越来越高，主控芯片性能直接影响着计算能力和信息安全。

目前存储市场主流主控芯片主要来自台湾或美国等厂商，在国内闪存主控芯片市场占据了主要份额，国产闪存主控芯片自给率有待进一步提升。根据国务院于 2015 年发布的《中国制造 2025》规划，我国芯片行业的发展目标为：“中国芯片自给率要在 2020 年达到 40%，2025 年达到 70%”。未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位。在贸易摩擦等宏观环境不确定性增加的背景下，加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度。本次募集资金投资项目的实施顺应了闪存主控芯片国产化的大趋势，有助于我国闪存主控芯片国产化进程的加快，提高国产闪存主控芯片自给率。

#### （2）有助于提升公司研发能力和盈利水平

公司作为采用 Fabless 模式经营的集成电路企业，闪存主控芯片研发设计是日常经营的重中之重，公司亟需改善办公环境、引进更多高端人才、提升现有研发条件，最终丰富公司的研发技术成果，提升公司产品核心竞争力，以支撑公司未来业务的持续发展。通过本次募集资金投资项目的建设，公司将购买所需 IP 及授权，配备一定数量的软件和研发测试设备，对外招聘并培养一批在闪存主控芯片设计领域具有丰富经验的核心技术人才，有助于提升公司研发能力。

与上一代 NAND Flash 相比，3D NAND Flash 通过增加立体硅层，以垂直半导体通道的方式排列，多层环绕式栅极（GAA）结构形成多电栅极存储器单元晶体管，既提高了单位面积存储密度，又改善了存储单元性能，具有容量密度高，读写速度快，耗电量节省等特征，对上一代 NAND Flash 呈现出替代趋势，预计市场份额将逐步扩大。通过本次募集资金投资项目的实施，可有效保证公司在 3D NAND Flash 移动存储主控芯片和 SSD 主控芯片等领域的技术突破，将较大程度提升公司在高端主控芯片领域的科研能力及加快公司科研成果的产业化转化速度，提升公司产品各方面性能，进一步稳固公司在移动存储细分行业中的领先地位，拓展公司在 SSD 细分行业中的市场份额，有助于提升公司的整体盈利水平。

## 第五节风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

#### （一）核心技术人员流失的风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高，尤其是核心技术人员，对公司的技术研发、研发团队建设等具有至关重要的作用。截至报告期末，发行人的技术和研发人员数量为 103 人，占员工总人数的 28.69%。如果未来同行业竞争对手通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或受其他因素影响导致公司技术人才流失，将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

#### （二）宏观经济环境变动风险

随着宏观经济形势的变化，存储产品下游应用领域的市场景气度可能存在波动，尤其是在国际贸易摩擦、经贸对抗的宏观环境下，全球经济发展面临新的不确定性，进而对全球经济增长造成不利影响，而宏观经济环境的变化会进一步影响存储产品下游应用领域的市场景气度，进而影响存储行业的利润水平。公司产品销售包括内销和外销，内销客户主要集中在深圳及周边地区，外销客户主要集中在香港地区，并通过香港地区的物流、贸易平台辐射、服务全球消费者。宏观经济环境的恶化将会使下游客户的需求下降，进而对公司的经营业绩带来不利影响。

#### （三）新冠疫情带来的业绩下滑风险

2020 年一季度新冠肺炎疫情在国内爆发，受国内疫情防控的影响，对公司的短期经营造成了一定不利影响。随着国内疫情得到有效控制，公司生产经营已得到有序恢复。但目前新冠肺炎疫情在国外呈现蔓延、爆发趋势，疫情的持续时间及影响范围尚不明朗，全球经济环境可能会发生进一步恶化，国外市场对存储产品的需求将可能因临时性海关封锁、物流受限等因素受到影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。如果未来全球疫情继续对社会经济及公众生活消费方式造成重大不利变化，公司的业绩将在一定期间内面临下滑的风险。

#### **（四）原材料价格波动风险**

公司产品主要为 NAND Flash 存储模组，产成品的成本构成中 NAND Flash 存储晶圆的占比较高，且市场上的 NAND Flash 存储晶圆主要由少数几家大型存储原厂生产、供应。随着 NAND Flash 工艺技术的不断进步及新技术、新工艺产线的陆续投产，市场中总的存储当量供给快速增长，同时，随着社会科技进步，电子产品数字化、智能化的快速发展，社会各行业对存储当量的需求也不断上升。因此，受上下游技术进步及存储原厂产能扩张计划等导致市场总体供需情况变化，NAND Flash 存储晶圆及存储产品价格呈现周期性变动的特征。虽然 NAND Flash 存储晶圆的价格变动与下游存储产品的价格会相互影响并呈现一致趋势，但由于价格传导以及生产周期等因素影响，若未来 NAND Flash 存储晶圆价格大幅波动，将导致存储产品的利润率出现大幅波动，甚至可能需对公司存货等资产计提大额跌价准备，从而大幅减少公司盈利，在极端情况下将有可能导致公司营业利润出现周期性下滑，甚至出现亏损。

#### **（五）客户集中度较高的风险**

公司存储卡和存储盘产品主要面向消费级市场，产品最终使用客户多为个人消费者。报告期内，公司专注于技术研发，在产品销售时主要通过少数在行业内具有资源比较优势的渠道分销商和具有一定品牌影响力的品牌客户进行产品销售，因此，公司呈现客户集中度较高的情况。报告期各期，公司向前五大客户的销售额占同期营业收入的比例分别为 67.77%、63.49%和 64.49%，占比较高。虽然随着公司经营规模的快速增长，公司已根据市场情况和企业发展要求进一步扩展了销售渠道，公司客户集中度呈现下降趋势，但如果主要客户的经营和资信情况发生重大不利变化，仍将对公司经营产生不利影响。

#### **（六）收入的季节性波动风险**

集成电路设计行业存在一定的季节性特征，主要与下游终端产品的市场需求相关，同时，公司主要产品包括存储卡模组、存储盘模组及固态硬盘模组等存储产品，由于行业和终端消费市场特性，每年第四季度和次年的第一季度由于节日和假期较多，如我国的国庆节、“双 11”、春节以及境外的圣诞节等，属于上述消费品的传统销售旺季，同时受产品生产周期以及渠道流转周期的影响，公司和下游客户需要提前备货，导致公司下半年的营业收入占比相对较高，具有一定的季

节性特征。若未来公司下游客户的采购计划仍具有季节性，可能对公司执行研发和销售计划，资金使用等经营活动具有一定影响，并导致公司的营业收入存在一定的季节性波动。

#### **（七）关于无法充分获取NAND Flash存储晶圆的风险**

NAND Flash 存储晶圆是发行人产品的主要原材料，由于全球 NAND Flash 存储晶圆供货商只有三星电子（SAMSUNG）、海力士（SK Hynix）、美光（Micron）和英特尔（Intel）、西部数据/闪迪（SanDisk）和铠侠（KIOXIA）等少数大型企业，NAND Flash 市场呈现寡头垄断特征，货源供应受上述存储原厂的产能情况和其执行的市场销售政策影响较大。受益于国家对存储器芯片的重视度越来越高，在国家产业资金和政策层面的高度支持下，国内逐步成长出如长江存储（YMTC）、合肥长鑫等国产存储器芯片生产厂商，其中，长江存储（YMTC）经过多年的研发和设备投入，已开始逐步量产并向市场供应 NAND Flash 芯片产品，从根本上打破了 NAND Flash 芯片长期由境外厂商垄断的市场格局。但如果在未来的业务发展过程中，由于地缘政治或其他原因，发行人不能获取持续、稳定的 NAND Flash 存储晶圆供应，将会对公司的生产经营造成不利影响。

#### **（八）实际控制人控制风险**

本次公开发行股票前后，李虎、田华夫妇为公司的实际控制人，其可以通过行使表决权等方式对公司的人事、生产经营及管理决策施加重大影响。公司自成立以来未出现实际控制人利用其地位损害公司和其他股东利益的情况，并已建立一系列制度可有效避免实际控制人操纵公司或损害公司利益情况的发生，且制度执行情况良好，但未来若相关制度不能得到严格执行或实际控制人对公司生产经营进行不当干预，公司仍存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。

#### **（九）规模扩张引发的管理风险**

公司本次公开发行股票后，总资产与净资产将大幅度增加，对公司组织结构、管理体系以及经营管理人才都提出了更高的要求。随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影

响，制约公司的发展。

#### **（十）募集资金投资项目实施过程中的风险**

公司本次募集资金投资项目包括 3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目、SSD 主控芯片技术开发应用及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目等。公司对本次募集资金投资项目的建设规模、设备及无形资产购置、人员、技术的配置方案等进行了充分论证，募集资金投资项目的实施将进一步提升公司的核心竞争力、保证公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力。但如募集资金投资项目在建设过程中出现管理不善导致不能如期实施、市场环境突变或市场竞争加剧等情形，将对公司募集资金投资项目的实施和盈利能力产生不利影响。

#### **（十一）募投项目新增折旧摊销影响经营业绩的风险**

公司募集资金投资项目将新增固定资产、无形资产等非流动资产投资，项目正常实施后每年新增折旧摊销金额较大。若市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧摊销大量增加而导致经营业绩下降的风险。

#### **（十二）法律风险**

在技术高度密集的集成电路行业，为了保持技术优势和竞争力，建立核心专利壁垒已经成为产业共识。在集成电路领域，已掌握领先技术的企业会通过及时申请专利的方式形成核心技术护城河，并运用专利维权，向竞争对手发起专利战。知识产权诉讼，尤其是专利诉讼已成为阻碍竞争对手经营发展的重要策略。

公司高度重视知识产权管理，制定了专门的知识产权管理制度。截至本招股说明书摘要签署之日，公司已获授权专利110项（其中发明专利33项），在申请专利100项（其中发明专利85项）；拥有集成电路布图设计专有权6项；拥有软件著作权72项。虽然公司已针对公司的核心技术采取了知识产权保护措施，且对于一些成熟的IP或技术也进行了外购或获取了必要的授权，但仍然不能排除出现公司部分核心技术被竞争对手模仿，或因国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素导致知识产权出现纠纷或诉讼的可能性。

## **二、重要合同**

本公司的重要合同包括与部分主要客户签订的框架协议、与部分主要供应商签订的框架协议、与设备供应商签订的设备采购合同、重大借款合同、重大综合授信合同、重大担保合同、供应链服务协议以及与东莞证券股份有限公司签署的《保荐协议》及《主承销协议》等。

## **三、重大诉讼或仲裁事项**

### **（一）公司重大诉讼及仲裁事项**

截至本招股说明书摘要签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动和未来前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁或行政处罚的事项。

### **（二）控股股东或实际控制人的重大诉讼或仲裁**

截至本招股说明书摘要签署之日，公司控股股东、实际控制人未涉及重大诉讼或仲裁事项。

### **（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重大诉讼或仲裁及刑事诉讼事项**

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近3年不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

截至本招股说明书摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未涉及重大诉讼或仲裁事项，亦不存在刑事诉讼事项。



## 第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行之各方当事人

各方当事人	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	深圳市德明利技术股份有限公司	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋A座2501、2401	0755-23579117	0755-23572708	田华
保荐人 (主承销商)	东莞证券股份有限公司	东莞市莞城区可园南路一号	0769-22119285	0769-22119285	孔令一 孙守恒
律师事务所	广东信达律师事务所	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼	0755-88265288	0755-88265537	沈琦雨 周晓静
会计师事务所	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室	010-82330558	010-82327668	杨春盛 何海文
资产评估机构	联合中和土地房地产资产评估有限公司	福州市鼓楼区湖东路168号宏利大厦写字楼27D	0591-87818242	0591-87814517	徐达 葛蒞
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼	0755-21899999	0755-21899000	-
收款银行	中国工商银行股份有限公司东莞市分行	-	-	-	-
拟上市的 证券交易所	深圳证券交易所	-	0755-88668888	0755-82083164	-

### 二、与本次发行上市有关的重要日期

刊登发行公告日期	2022年6月21日
申购日期	2022年6月22日
缴款日期	2022年6月24日
股票上市日期	本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在深圳证券交易所上市

## 第七节备查文件

### 一、备查文件内容

- (一) 发行保荐书；
- (二) 财务报告及审计报告；
- (三) 内部控制鉴证报告；
- (四) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (五) 法律意见书及律师工作报告；
- (六) 公司章程（草案）；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查文件查阅时间、地点

本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股说明书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9：30-11：30，下午2：00-4：00。

投资者也可在巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅招股说明书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页）



深圳市德明利技术股份有限公司

2022年6月20日